

2021年3月期 決算説明会

2021年5月19日

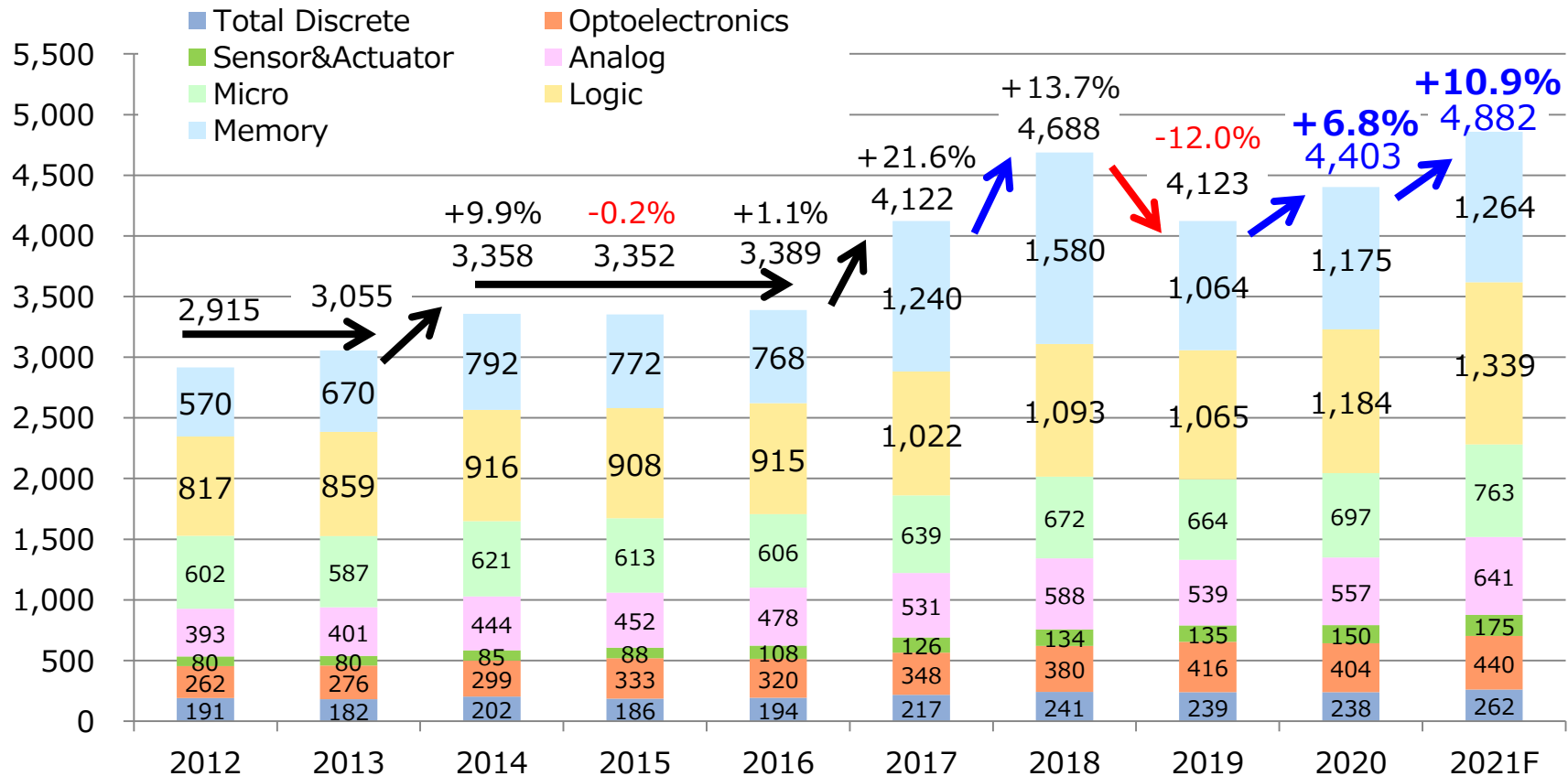
株式会社フジミインコーポレーテッド

市場概況

世界半導体市場動向 (年次実績/予測) 用途別

- ・WSTSによると、2020年成長率は、5Gスマホの増加やライフスタイルの変化が半導体需要を押し上げ、前年比**+6.8%** (米中貿易摩擦の激化によるサプライチェーン断絶リスクに対する在庫積増しも重なった)
- ・2021年予測では、新型コロナの影響で先行きは依然不透明であるものの、社会のデジタル化への動きが加速するものとして、**+10.9%** の成長が見込まれている

単位：億ドル

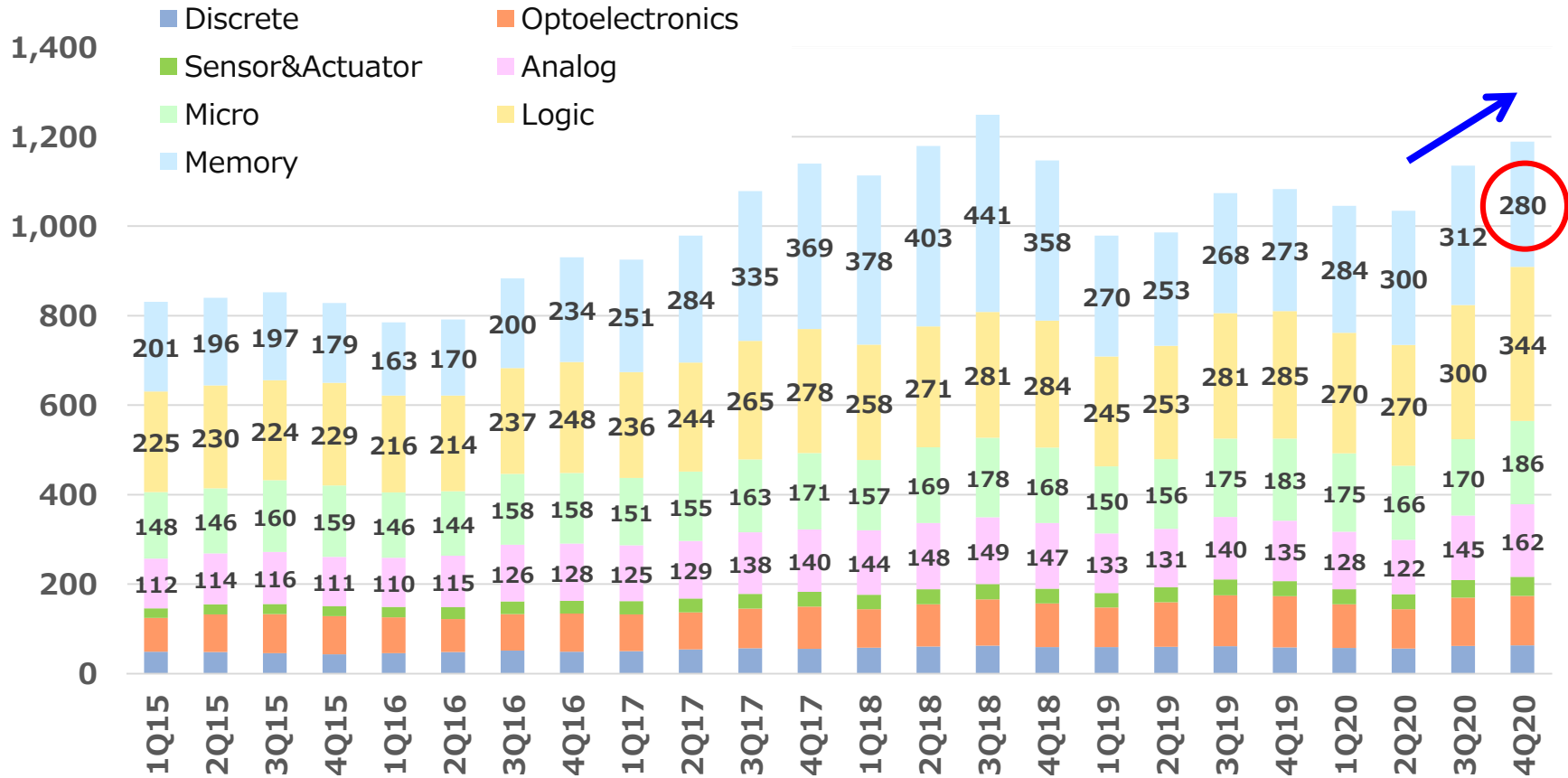


出所：WSTS (実績 2021/3/17, 予想 2020/12/1)

世界半導体市場動向 (四半期実績) 用途別

- 世界半導体市場は、2020年3Q (7-9月期) 以降、回復
- メモリデバイスは、2020年4Q (10-12月期) にデータセンター向けで一服感があった

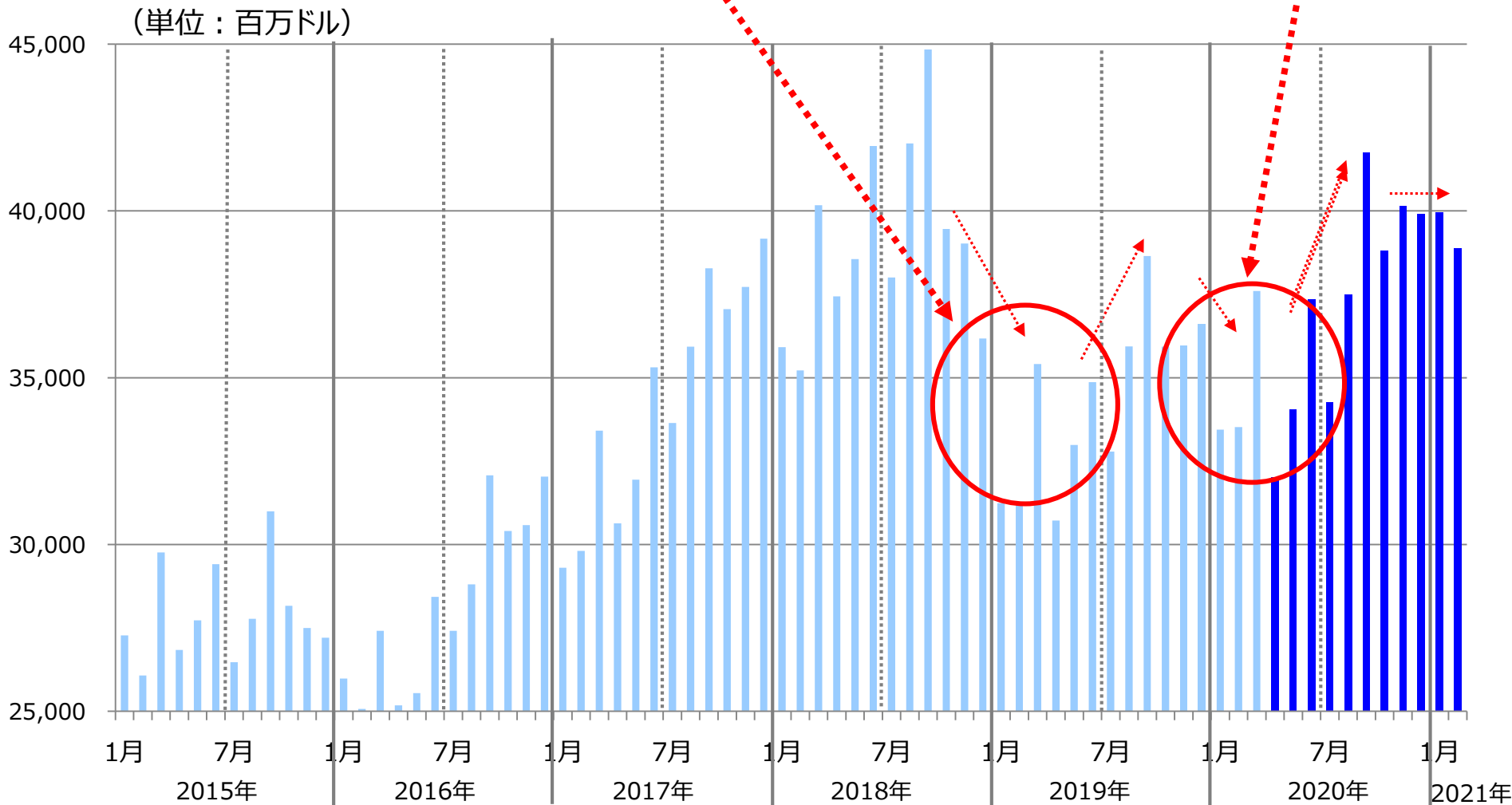
単位：億ドル



出所：WSTS

世界半導体市場動向 (月次実績 ※2021年2月まで)

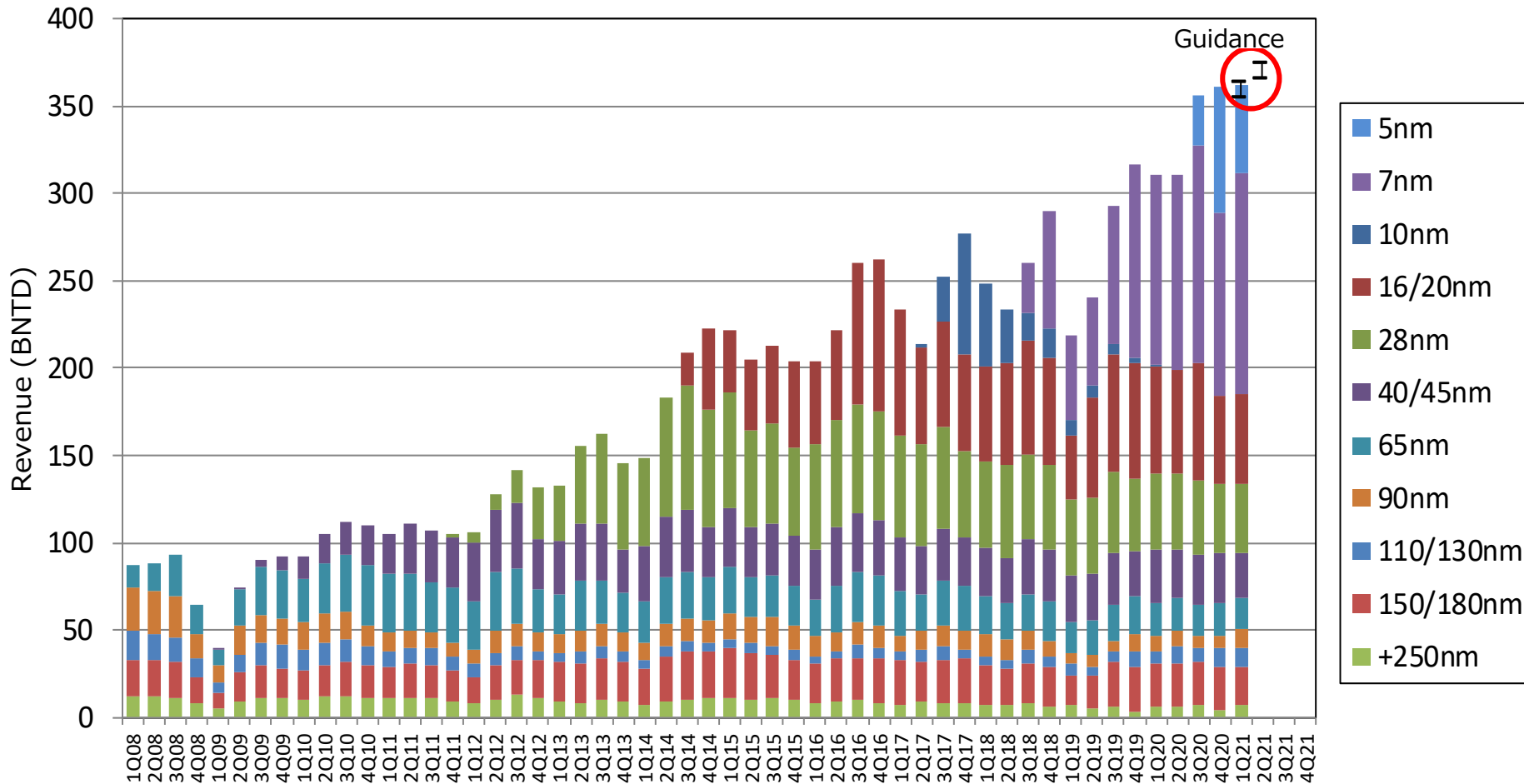
データセンターブーム反動で2019年1月から7月まで半年ほど低迷後、北米、中国を中心に回復していたが
新型コロナの影響で2020年1月より再び下降。 4月で底打ちし再び回復し、2020年9月以降は高水準で推移



出所：WSTS (2021/5/17)

台湾セミコンダクター（TSMC）売上高（2021年1-3月期）

- ・21年1Q（1-3月期）、売上高は過去最高を更新
- ・21年2Q（4-6月期）も過去最高を更新見込（ガイダンスベース）
- ・Node別売上高では、7nmが増加、5nmは減少

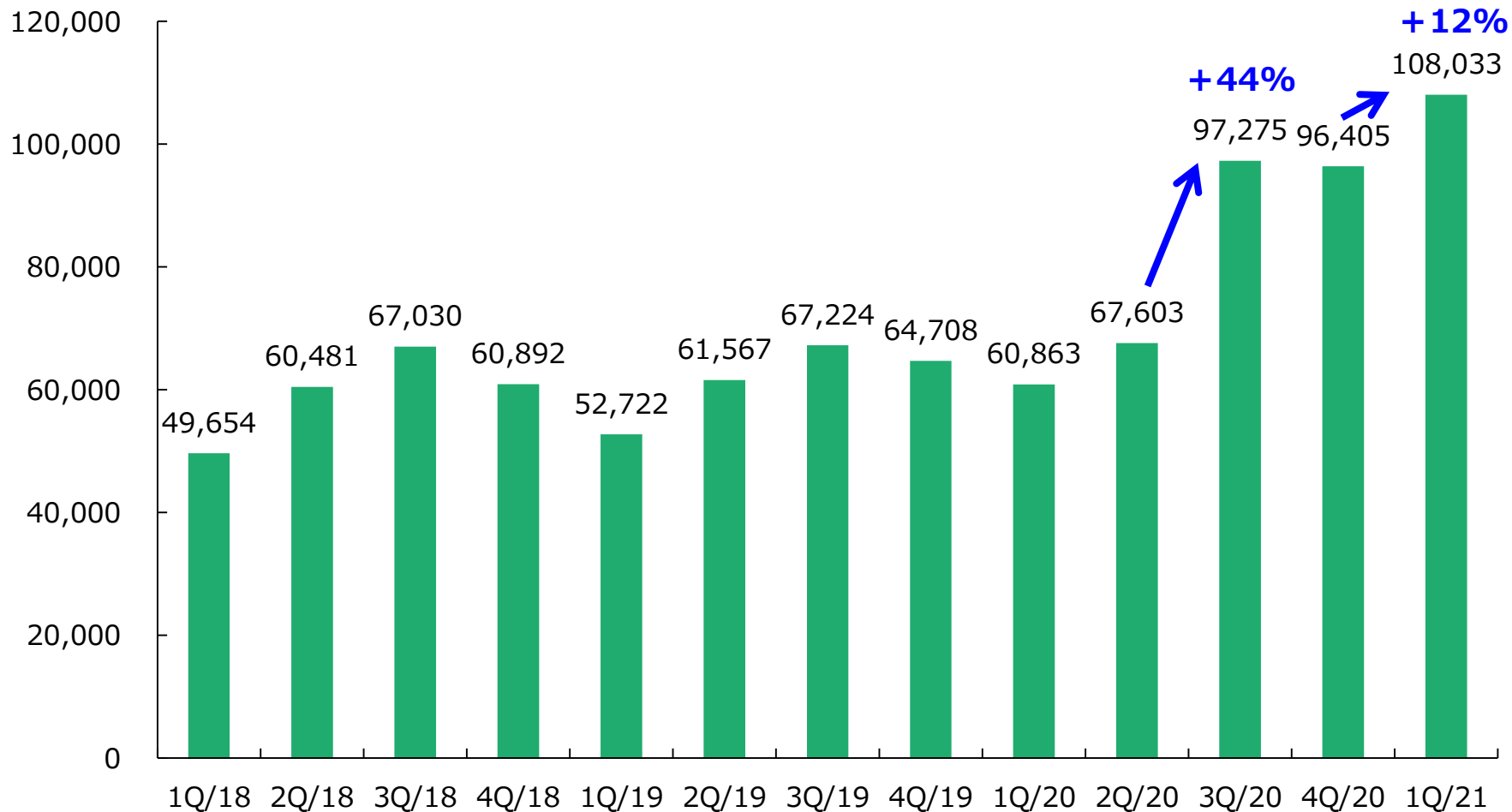


出所：TSMC公開情報よりフジミ作成

メディアテック 売上高 (2021年1-3月期)

- ・2020年3Q (7-9月期) の売上高はQoQ+44%、2021年1Q (1-3月期) はQoQ+12%
- ・2021年通期の売上高予想では、中華系スマホの需要拡大に伴い、過去最高の前年比4割増と発表

売上高 (MNTD)

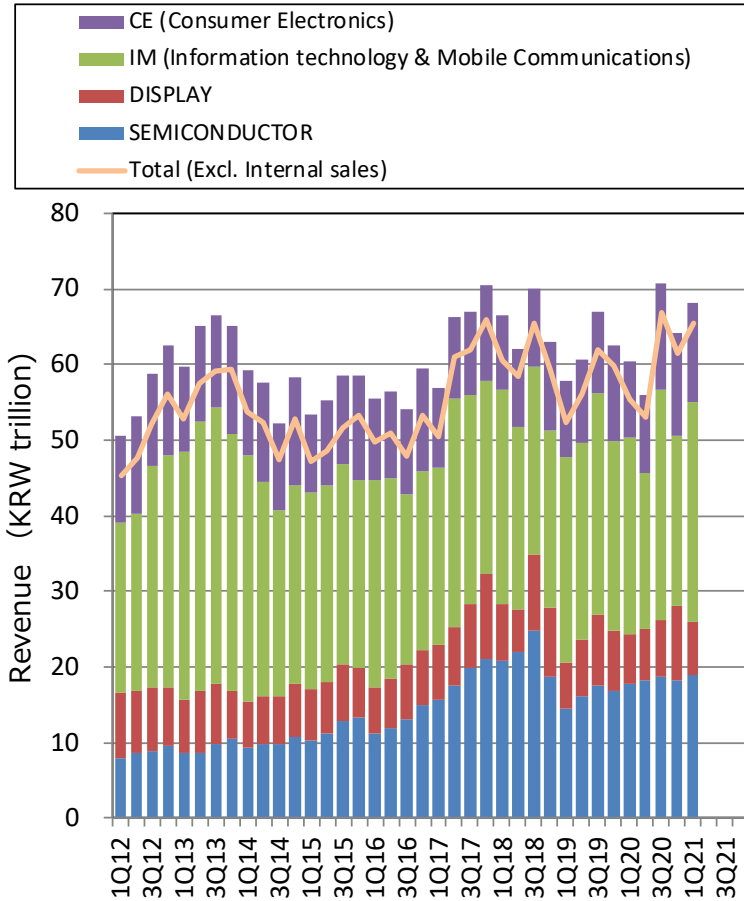


出所：メディアテック公開情報よりフジミ作成

サムスン電子 売上高 (2021年1-3月期)

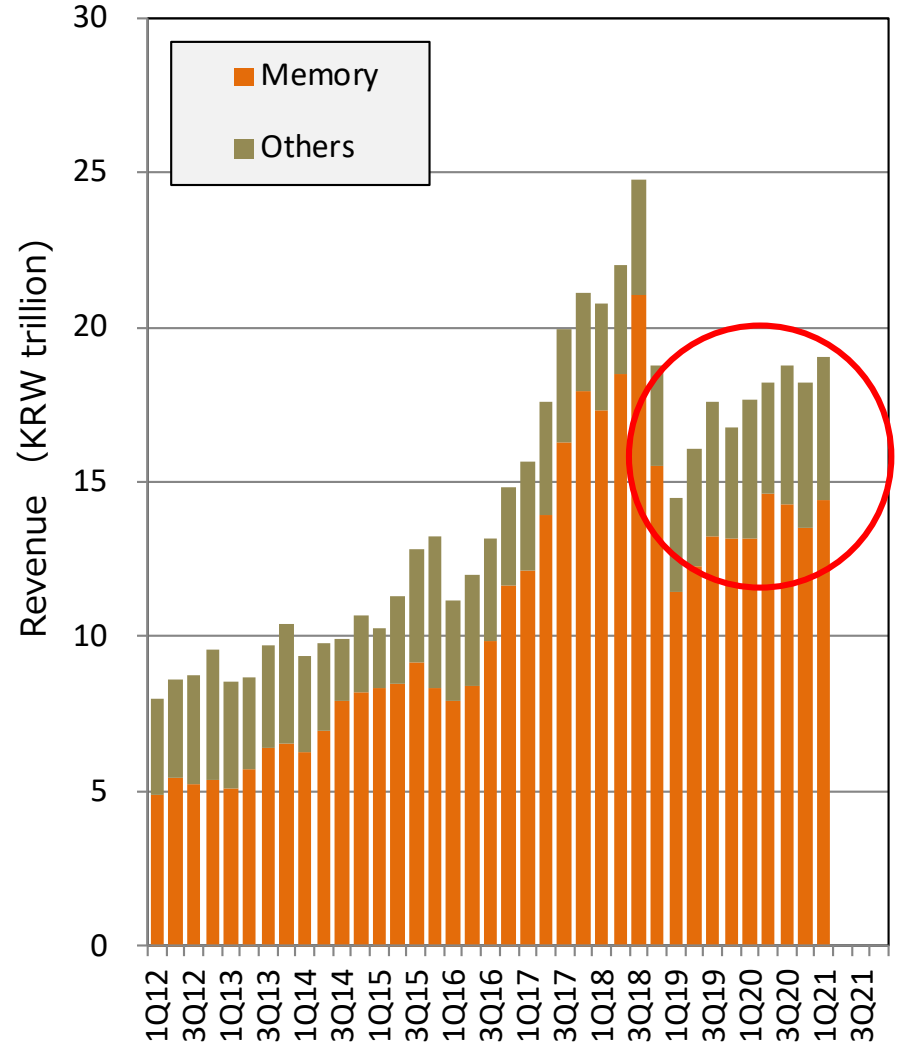
- ・半導体事業は、2020年4Q (10-12月期) は調整があったが、2021年1Q (1-3月期) は売上増加
- ・DRAMはPC、Mobile向けで堅調
- ・NANDはデータセンター、PC、Mobile向けで堅調

<サムスン電子 全社 売上高>



出所：サムスン電子公開情報よりフジミ作成

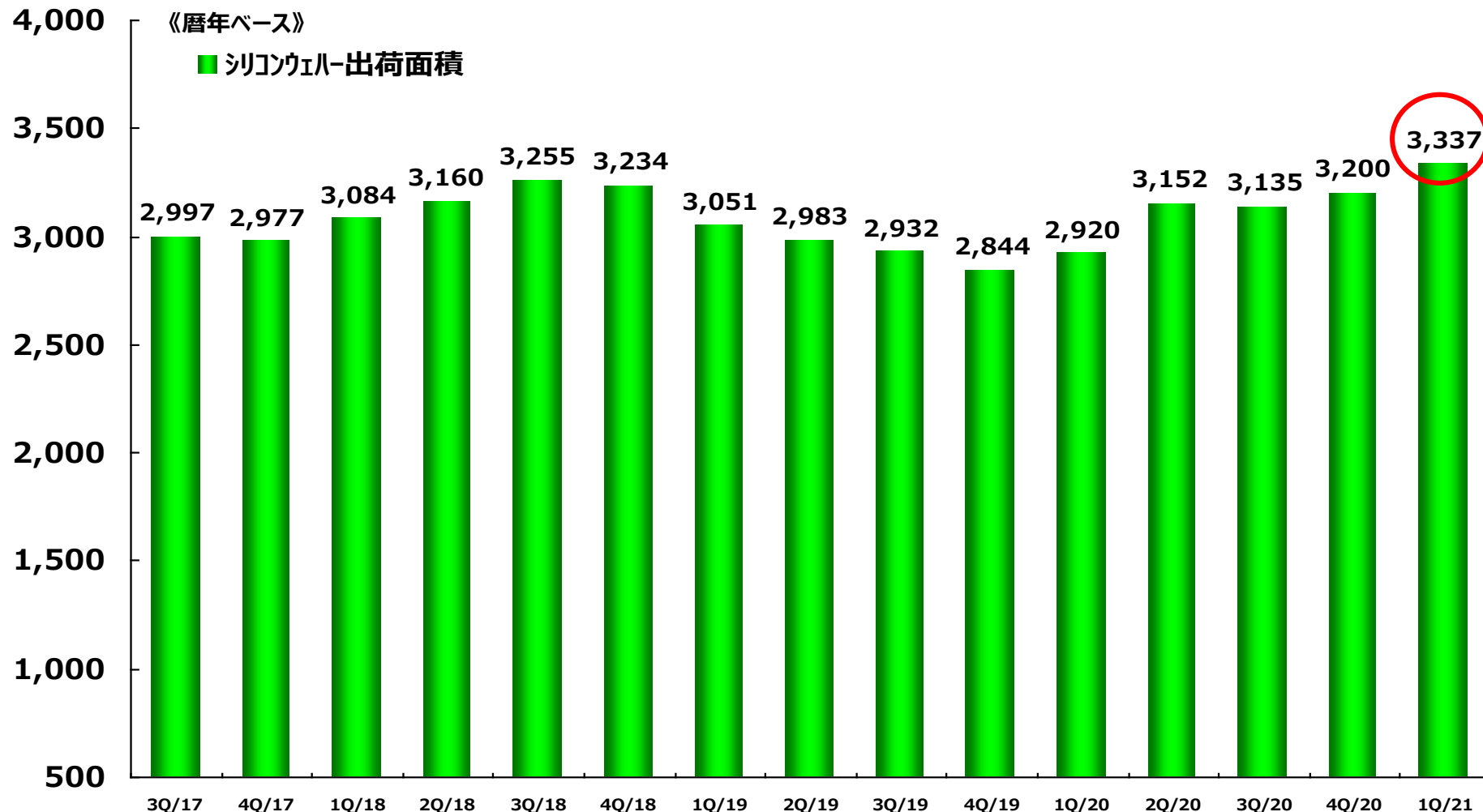
<サムスン電子 半導体事業 売上高>



シリコンウェハー出荷面積（四半期）

2021年1-3月期のシリコンウェハー出荷面積は、過去最高を更新

百万平方インチ



出所：SEMI (2021/5/3)

市場概況サマリー 2021年3月期(2020年4月-2021年3月)

マクロ環境

- コロナ感染症拡大により在宅関連需要（データセンター・PC）が増加
- コロナ感染症拡大及び米中貿易摩擦の激化によるサプライチェーン断絶リスクに対する在庫積み増し

半導体市場

- ロジック半導体 : サプライチェーン断絶リスクに備えた在庫積み増しの動きに伴い、中華系スマホ向けを中心に最先端分野が高稼働
- メモリ半導体 : 上期はデータセンター及びPC向けの在宅関連需要の増加及びサプライチェーン断絶リスクに備えた在庫積み増しの動きに伴い、最先端分野が高稼働であったが、下期はデータセンター向けに需要の一服感あり
- シリコンウェハー : 半導体需要の増加及びサプライチェーン断絶リスクに備えた在庫積み増しの動きに伴い、出荷面積は増加

非半導体市場

- 自動車、産業機械市場は上期に底を打ち、下期は回復に転じた

決算概要

業績概要 (通期実績)

単位：百万円	20年3月期	21年3月期					
	通期実績	期初予想('20/5)	修正予想('20/11)	修正予想('21/2)	通期実績	前年比	修正予想比('21/2)
売上高	38,408	非開示	39,500	41,000	41,956	+9.2%	+0.4%
営業利益	6,007		6,800	7,350	7,639	+27.2%	+2.2%
営業利益率	15.6%		17.2%	17.9%	18.2%	-	-
経常利益	6,177		6,850	7,350	7,709	+24.8%	+3.0%
経常利益率	16.1%		17.3%	17.9%	18.4%	-	-
当期純利益	4,270		5,200	5,500	5,607	+31.3%	+1.1%
当期純利益率	11.1%		13.2%	13.4%	13.4%	-	-

(前期比) ・最先端半導体デバイス向けCMP製品・シリコンウェハ向け製品の販売好調により、増収増益
 ・営業利益・経常利益は2期、当期純利益は3期連続で過去最高を更新

業績概要 (半期実績)

単位：百万円	20年3月期		21年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	前年同期比	前年下期比	下期実績	前年同期比	上期比
売上高	18,884	19,523	20,427	+8.2%	+4.6%	21,529	+10.3%	+5.4%
営業利益	2,863	3,144	3,718	+29.9%	+18.3%	3,920	+24.7%	+5.4%
営業利益率	15.2%	16.1%	18.2%	-	-	18.2%	-	-
経常利益	2,974	3,202	3,694	+24.2%	+15.3%	4,015	+25.4%	+8.7%
経常利益率	15.8%	16.4%	18.1%	-	-	18.7%	-	-
当期純利益	2,212	2,058	2,855	+29.1%	+38.7%	2,752	+33.8%	△3.6%
当期純利益率	11.7%	10.5%	14.0%	-	-	12.8%	-	-

・21/3期下期業績は、シリコンウェハー向け製品の販売が増加したことから、売上・利益共に上期を上回った（一方、CMPはメモリデバイス向け需要の一服感に伴い、上下フラット）

業績予想 (通期)

単位：百万円	20年3月期	21年3月期	22年3月期	
	通期実績	通期実績	通期予想	前年比
売上高	38,408	41,956	43,500	+3.7%
営業利益	6,007	7,639	8,500	+11.3%
営業利益率	15.6%	18.2%	19.5%	-
経常利益	6,177	7,709	8,600	+11.5%
経常利益率	16.1%	18.4%	19.8%	-
当期純利益	4,270	5,607	6,200	+10.6%
当期純利益率	11.1%	13.4%	14.3%	-

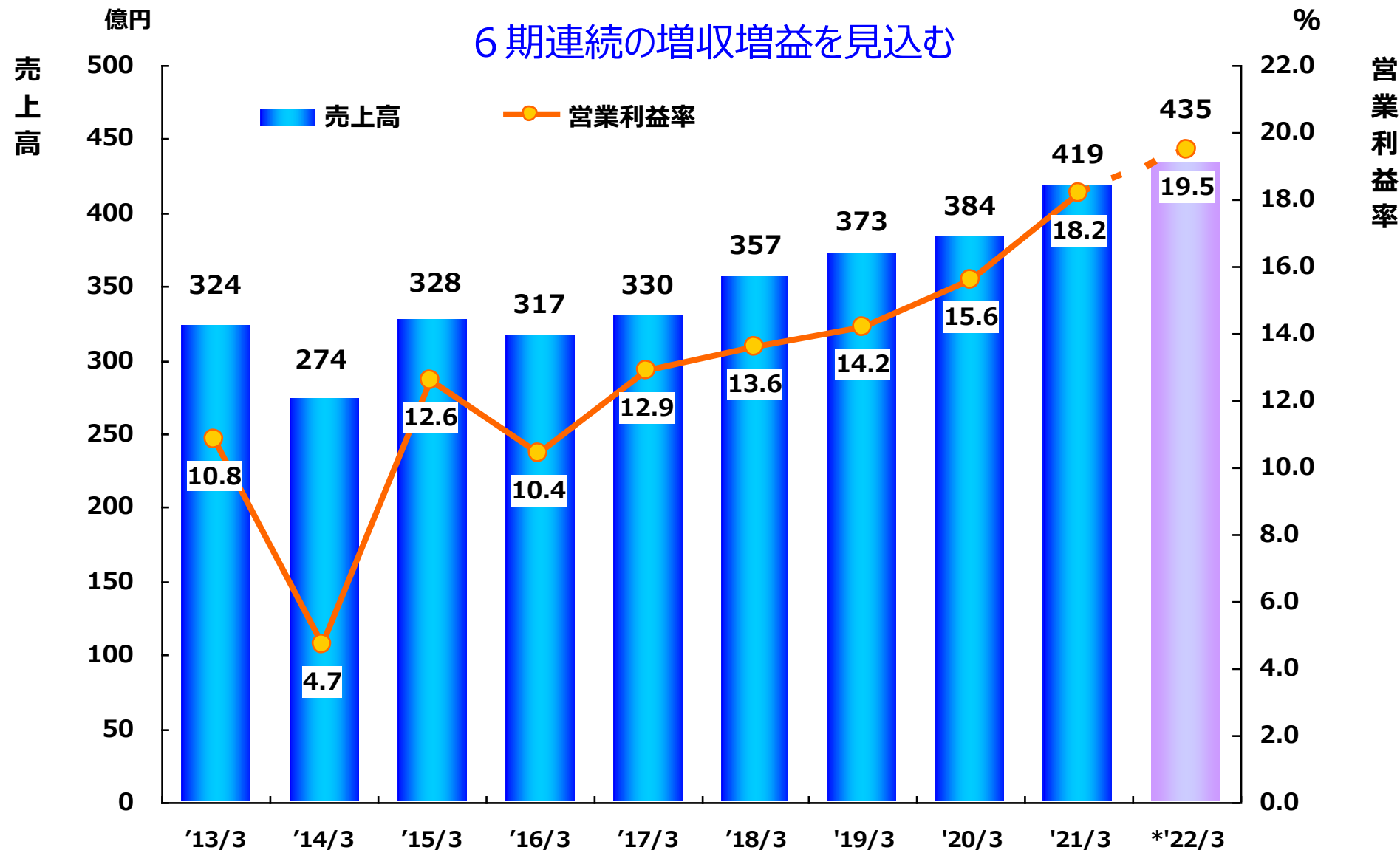
- ・半導体市場の好調に伴う最先端半導体デバイス向けCMP製品・シリコンウェハ向け製品の販売増加により、増収増益を見込む
- ・想定為替レート：105円/ドル

業績予想 (半期)

単位：百万円	21年3月期		22年3月期					
	上期実績	下期実績	上期予想	前年同期比	前年下期比	下期予想	前年同期比	上期比
売上高	20,427	21,529	21,000	+2.8%	△2.5%	22,500	+4.5%	+7.1%
営業利益	3,718	3,920	3,800	+2.2%	△3.1%	4,700	+19.9%	+23.7%
営業利益率	18.2%	18.2%	18.1%	-	-	20.9%	-	-
経常利益	3,694	4,015	3,850	+4.2%	△4.1%	4,750	+18.3%	+23.4%
経常利益率	18.1%	18.7%	18.3%	-	-	21.1%	-	-
当期純利益	2,855	2,752	3,000	+5.1%	+9.0%	3,200	+16.2%	+6.7%
当期純利益率	14.0%	12.8%	14.3%	-	-	14.2%	-	-

・コロナ収束に伴う経済回復を睨み、半導体関連用途、非半導体関連用途ともに、上期よりも下期に需要が強まることを想定し、下期の売上増加を見込む

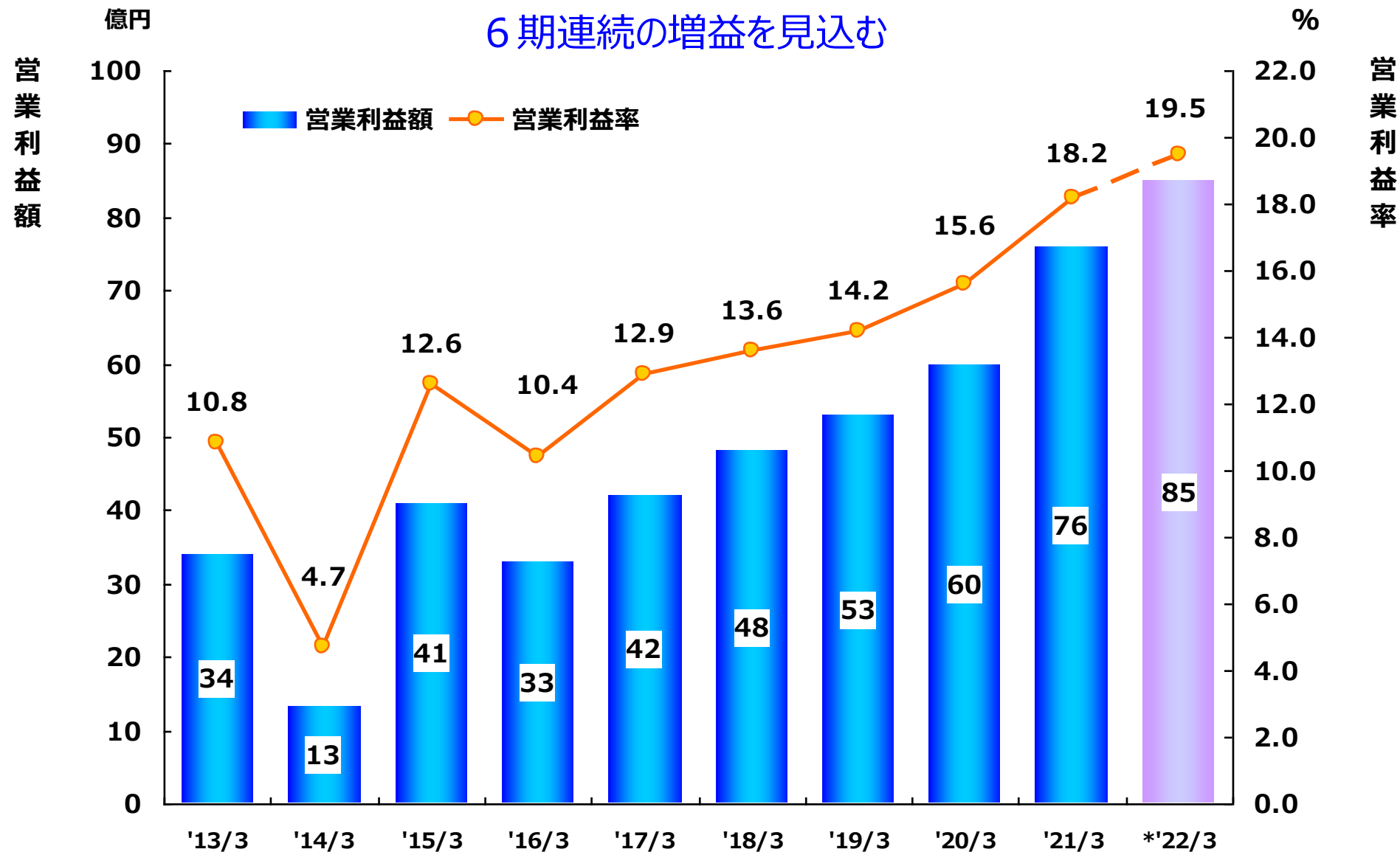
業績推移 (通期)



*'22/3は予想値

営業利益 (通期)

6期連続の増益を見込む



*'22/3は予想値

用途別売上高

用途別売上高 (通期実績)

単位：百万円		20年3月期	21年3月期	
		通期 実績	通期 実績	前年比
シリコンウエハー	ラッピング	3,838	4,604	+20.0%
	ポリシング	9,006	9,621	+6.8%
	切断	273	245	△10.2%
	計	13,118	14,472	+10.3%
CMP		17,361	20,037	+15.4%
ディスク	アルミディスク	1,961	1,668	△15.0%
	ガラスディスク	203	36	△81.9%
	計	2,164	1,705	△21.2%
機能材 溶射材	一般工業用(研磨材)	3,571	3,779	+5.8%
	一般工業用(非研磨材)	1,912	1,909	△0.2%
	計	5,483	5,688	+3.7%
製品売上高		38,128	41,903	+9.9%
商品売上高		279	52	△81.1%
売上高 合計		38,408	41,956	+9.2%

用途別売上高 (半期実績)

単位：百万円		20年3月期		21年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	前年同期比	前年下期比	下期実績	前年同期比	同年前期比
シリコンウエハー	ラッピング	1,834	2,004	2,158	+17.7%	+7.7%	2,446	+22.0%	+13.3%
	ポリシング	4,487	4,519	4,521	+0.8%	+0.0%	5,100	+12.9%	+12.8%
	切断	137	136	108	△20.4%	△20.0%	136	+0.2%	+25.3%
	計	6,458	6,660	6,788	+5.1%	+1.9%	7,683	+15.4%	+13.2%
CMP		8,483	8,878	10,055	+18.5%	+13.3%	9,982	+12.4%	△0.7%
ディスク	アルミディスク	983	978	926	△5.7%	△5.3%	741	△24.2%	△20.0%
	ガラスディスク	111	92	11	△89.7%	△87.6%	25	△72.4%	+122.9%
	計	1,094	1,070	938	△14.2%	△12.4%	766	△28.4%	△18.3%
機能材、溶射材	一般工業用(研磨材)	1,740	1,831	1,699	△2.3%	△7.2%	2,080	+13.6%	+22.4%
	一般工業用(非研磨材)	949	963	920	△3.0%	△4.5%	988	+2.6%	+7.4%
	計	2,689	2,794	2,619	△2.6%	△6.3%	3,068	+9.8%	+17.1%
製品売上高		18,724	19,404	20,401	+9.0%	+5.1%	21,501	+10.8%	+5.4%
商品売上高		160	119	25	△84.1%	△78.7%	27	△77.1%	+7.6%
売上高 合計		18,884	19,524	20,427	+8.2%	+4.6%	21,529	+10.3%	+5.4%

用途別売上高 (通期予想)

単位：百万円		20年3月期	21年3月期	22年3月期	
		通期実績	通期実績	通期予想	前年比
シリコンウエハー	ラッピング	3,838	4,604	4,650	+1.0%
	ポリシング	9,006	9,621	10,300	+7.0%
	切断	273	245	200	△18.5%
	計	13,118	14,472	15,150	+4.7%
CMP		17,361	20,037	21,000	+4.8%
ディスク	アルミディスク	1,961	1,668	1,650	△1.1%
	ガラスディスク	203	36	50	+35.7%
	計	2,164	1,705	1,700	△0.3%
機能材 溶射材	一般工業用(研磨材)	3,571	3,779	3,700	△2.1%
	一般工業用(非研磨材)	1,912	1,909	1,900	△0.5%
	計	5,483	5,688	5,600	△1.6%
製品売上高		38,128	41,903	43,450	+3.7%
商品売上高		279	52	50	△5.5%
売上高 合計		38,408	41,956	43,500	+3.7%

用途別売上高 (半期予想)

単位：百万円		21年3月期		22年3月期					
		上期実績	下期実績	上期予想	前年同期比	前年下期比	下期予想	前年同期比	同年前期比
シリコンウエハー	ラッピング	2,158	2,446	2,300	+6.5%	△6.0%	2,350	△3.9%	+2.2%
	ポリシング	4,521	5,100	5,100	+12.8%	+0.0%	5,200	+1.9%	+2.0%
	切断	108	136	100	△8.2%	△26.7%	100	△26.6%	+0.2%
	計	6,788	7,683	7,500	+10.5%	△2.4%	7,650	△0.4%	+2.0%
CMP		10,055	9,982	10,100	+0.4%	+1.2%	10,900	+9.2%	+7.9%
ディスク	アルミディスク	926	741	750	△19.1%	+1.1%	900	+21.4%	+20.0%
	ガラスディスク	11	25	25	+119.1%	△1.7%	25	△0.5%	+1.2%
	計	938	766	775	△17.4%	+1.1%	925	+20.6%	+19.4%
機能材、溶射材	一般工業用(研磨材)	1,699	2,080	1,750	+3.0%	△15.9%	1,950	△6.2%	+11.5%
	一般工業用(非研磨材)	920	988	850	△7.6%	△14.0%	1,050	+6.2%	+23.5%
	計	2,619	3,068	2,600	△0.7%	△15.3%	3,000	△2.2%	+15.4%
製品売上高		20,401	21,501	20,975	+2.8%	△2.4%	22,475	+4.5%	+7.2%
商品売上高		25	27	25	△1.9%	△8.8%	25	△8.9%	+0.0%
売上高 合計		20,427	21,529	21,000	+2.8%	△2.5%	22,500	+4.5%	+7.1%

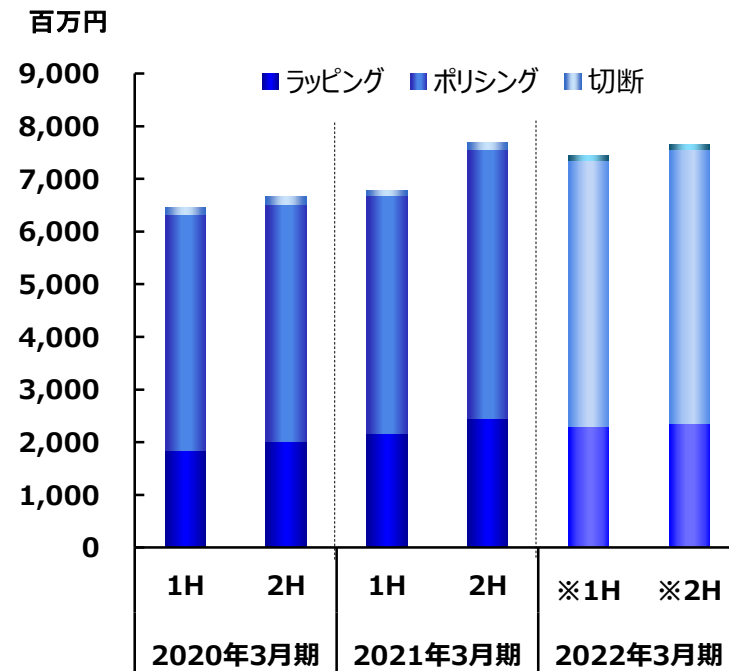
シリコンウェハー売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

<<通期>>

単位：百万円		20年3月期		21年3月期		22年3月期	
		通期実績		通期実績	前年比	通期予想	前年比
シリコンウェハー	ラッピング	3,838		4,604	+20.0%	4,650	+1.0%
	ポリシング	9,006		9,621	+6.8%	10,300	+7.0%
	切断	273		245	△10.2%	200	△18.5%
	計	13,118		14,472	+10.3%	15,150	+4.7%

<<半期>>

単位：百万円		20年3月期		21年3月期		22年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
シリコンウェハー	ラッピング	1,834	2,004	2,158	2,446	2,300	2,350
	ポリシング	4,487	4,519	4,521	5,100	5,100	5,200
	切断	137	136	108	136	100	100
	計	6,458	6,660	6,788	7,683	7,500	7,650



(21/3) 半導体業界の高稼働により増収
 20/3期のラッピングは、6,8インチシリコンウェハー市場の減速により伸びず
 一方、21/3期は自動車及び産業機械向けの稼働が急回復した為+20%
 (22/3) 半導体業界の高稼働の継続を想定し増収を予想

*'22/3は予想

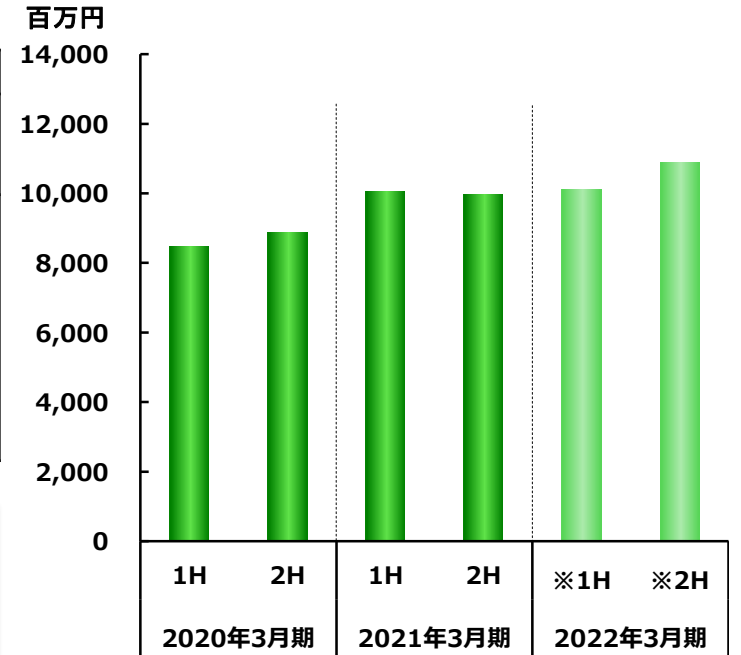
CMP売上高 (通期実績・予想、半期実績・予想)

<<通期>>

単位：百万円	20年3月期	21年3月期		22年3月期	
	通期実績	通期実績	前年比	通期予想	前年比
CMP	17,361	20,037	+15.4%	21,000	+4.8%

<<半期>>

単位：百万円	20年3月期		21年3月期		22年3月期	
	上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
CMP	8,483	8,878	10,055	9,982	10,100	10,900



(21/3) 堅調な半導体市場に伴い、最先端半導体デバイス向けで増収

(22/3) 堅調な半導体市場の継続を想定し最先端半導体デバイス向けで増収を予想 但し、メモリー半導体在庫調整が続くとみて上期売上は限定的、下期にはコロナ回復と5G本格化を想定

*'22/3は予想

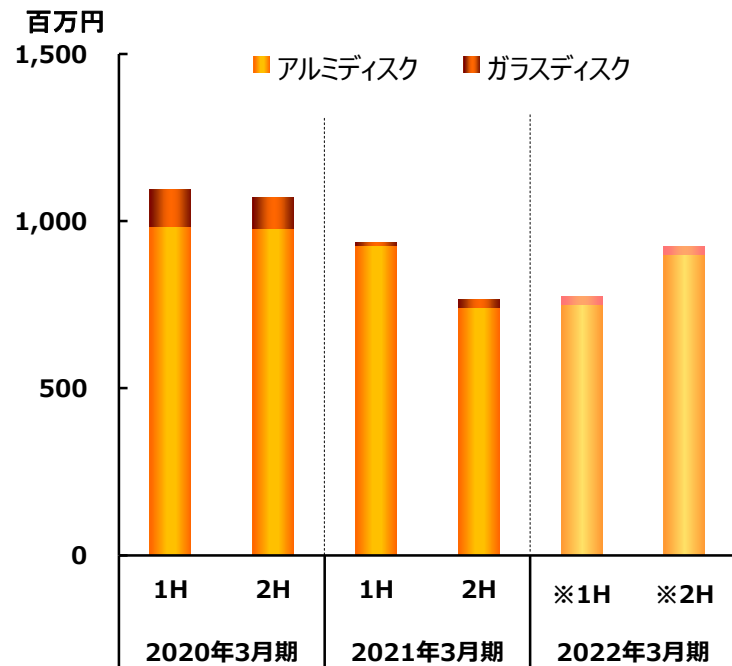
ディスク売上高 (通期実績・予想、半期実績・予想)

<<通期>>

単位：百万円		20年3月期		21年3月期		22年3月期	
		通期実績		通期実績	前年比	通期予想	前年比
ディスク	アルミディスク	1,961		1,668	△15.0%	1,650	△1.1%
	ガラスディスク	203		36	△81.9%	50	+35.7%
	計	2,164		1,705	△21.2%	1,700	△0.3%

<<半期>>

単位：百万円		20年3月期		21年3月期		22年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
ディスク	アルミディスク	983	978	926	741	750	900
	ガラスディスク	111	92	11	25	25	25
	計	1,094	1,070	938	766	775	925



(21/3) 市場縮小と顧客の生産プロセス変更の影響により減収
 (22/3) アルミ向け製品の下期需要回復を想定し通期では前年並みを予想

*'22/3は予想

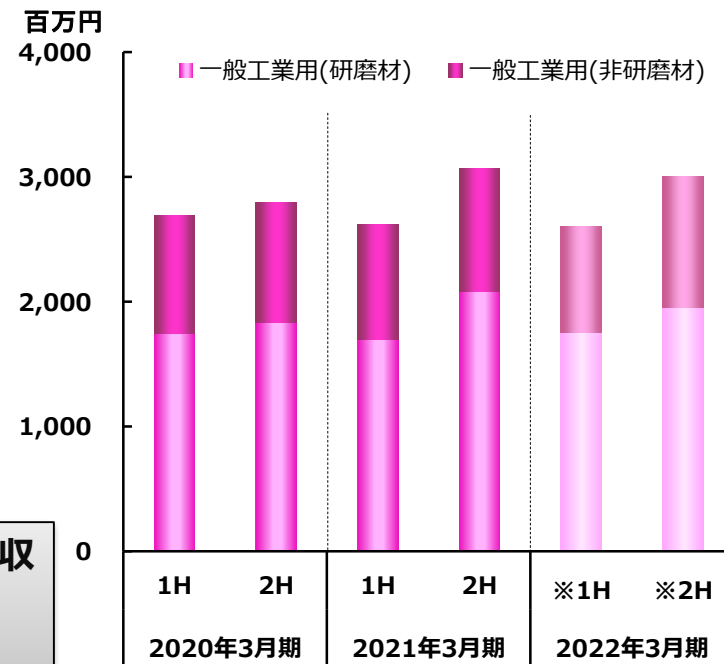
機能材・溶射材売上高 (通期実績・予想、半期実績・予想)

<<通期>>

単位：百万円		20年3月期		21年3月期		22年3月期	
		通期実績		通期実績	前年比	通期予想	前年比
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	3,571		3,779	+5.8%	3,700	△2.1%
	一般工業用(非研磨材)	1,912		1,909	△0.2%	1,900	△0.5%
	計	5,483		5,688	+3.7%	5,600	△1.6%

<<半期>>

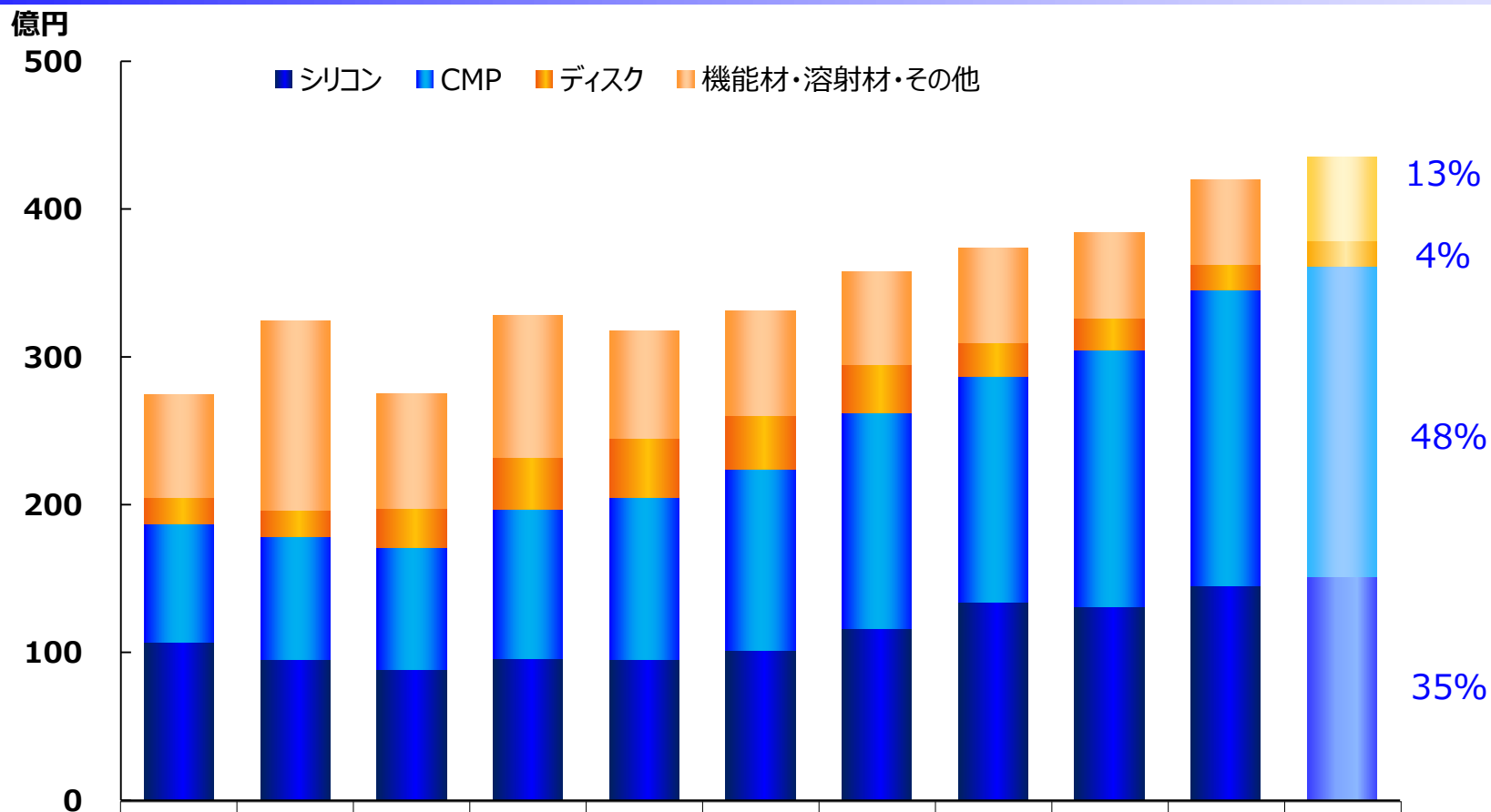
単位：百万円		20年3月期		21年3月期		22年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	1,740	1,831	1,699	2,080	1,750	1,950
	一般工業用(非研磨材)	949	963	920	988	850	1,050
	計	2,689	2,794	2,619	3,068	2,600	3,000



【研磨材】(21/3) 下期に自動車、産業機械向けの回復も見られ増収
(22/3) 前年並み予想
【〃以外】(22/3) 触媒担体向け機能性材で減収も、
半導体装置向け溶射材増収で前年並み予想

*'22/3は予想

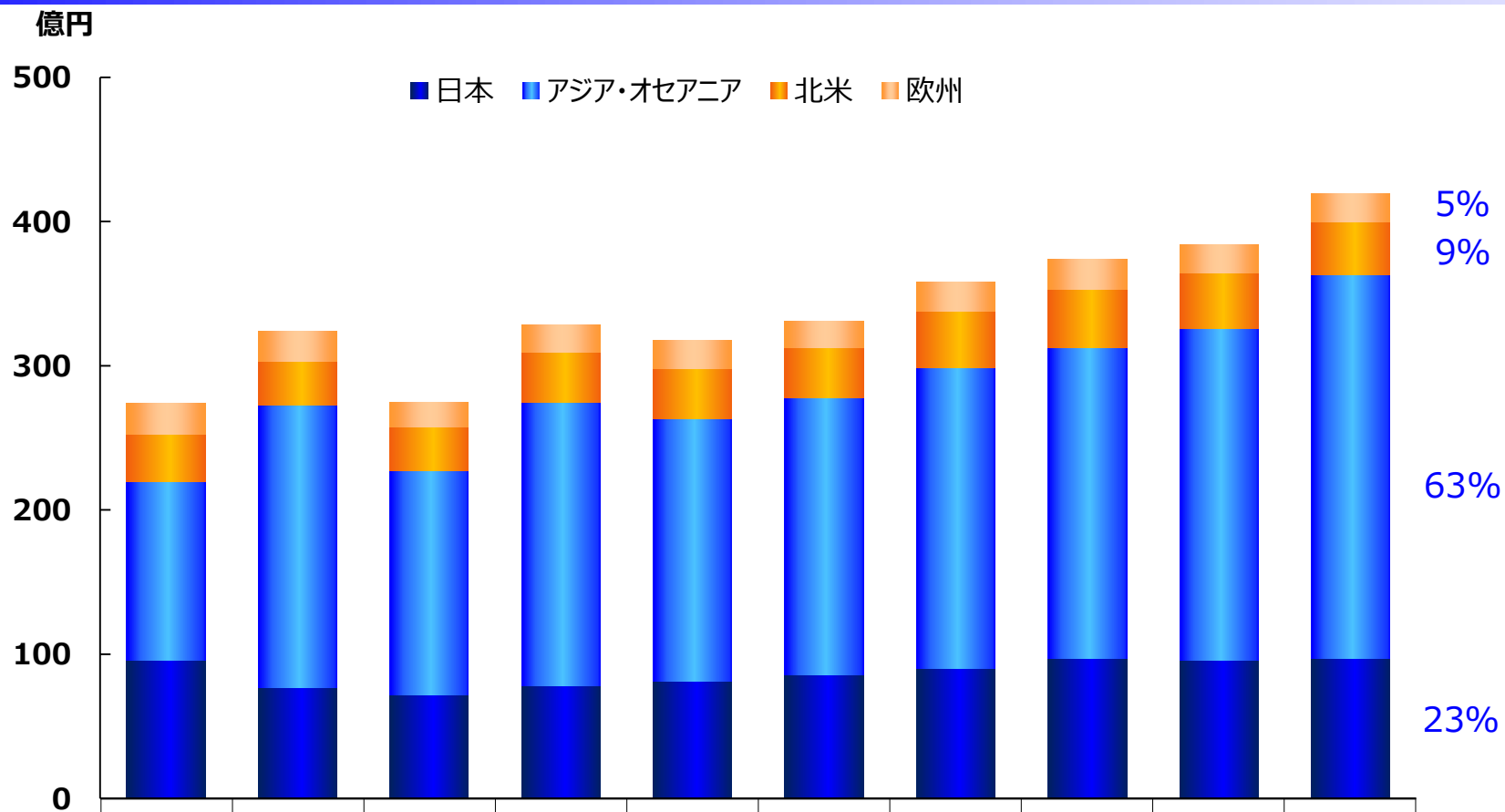
用途別売上高 (通期)



	'12/3	'13/3	'14/3	'15/3	'16/3	'17/3	'18/3	'19/3	20/3	'21/3	*'22/3
機能材・溶射材・その他	69	127	77	96	72	70	63	64	57	57	56
ディスク	17	18	26	34	40	36	32	22	21	17	17
CMP	80	83	82	101	109	122	146	153	173	200	210
シリコン	106	94	88	95	94	100	115	133	131	144	151
計	274	324	274	328	317	330	357	373	384	419	435

*'22/3は予想

地域別売上高 (通期 仕向先別)

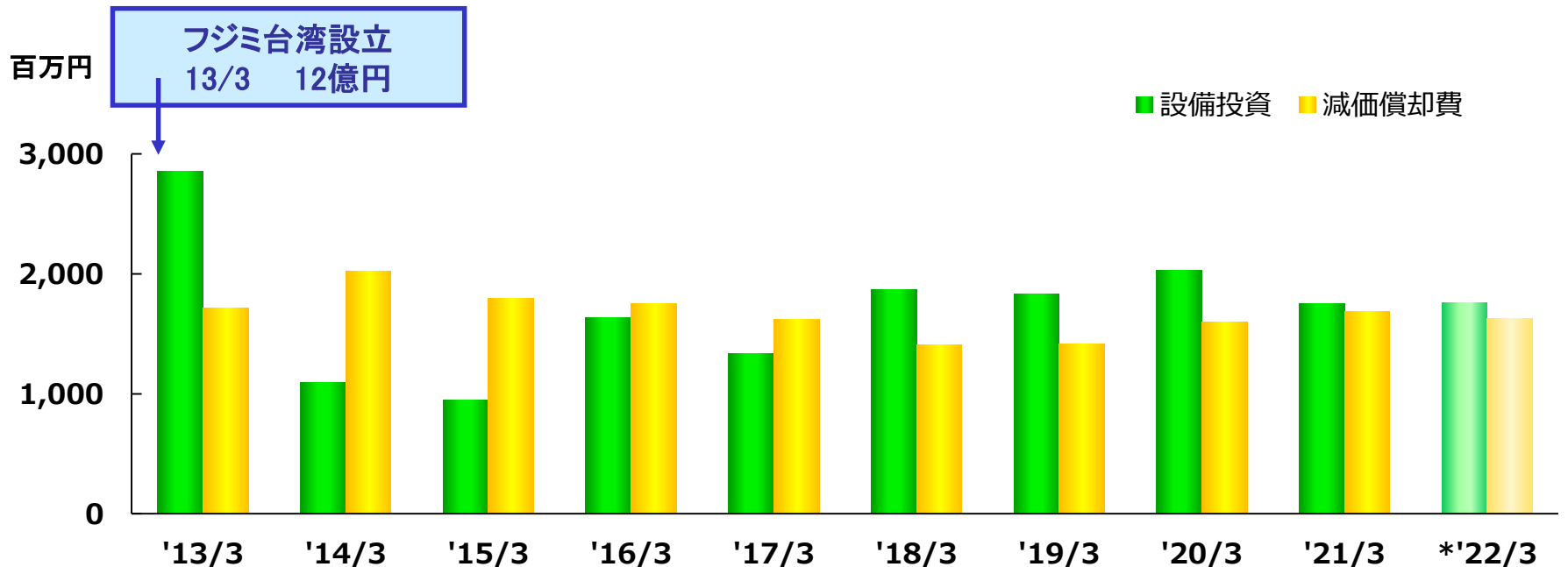


	'12/3	'13/3	'14/3	'15/3	'16/3	'17/3	'18/3	'19/3	'20/3	'21/3
■ 欧州	21	21	17	18	19	18	20	21	20	19
■ 北米	32	30	30	35	34	35	39	40	38	36
■ アジア・オセアニア	123	195	154	196	182	191	208	215	229	265
■ 日本	95	76	72	77	81	85	90	96	95	97
計	274	324	274	328	317	330	357	373	384	419

設備投資額
減価償却費
研究開発費

設備投資・減価償却費（通期実績・通期計画）

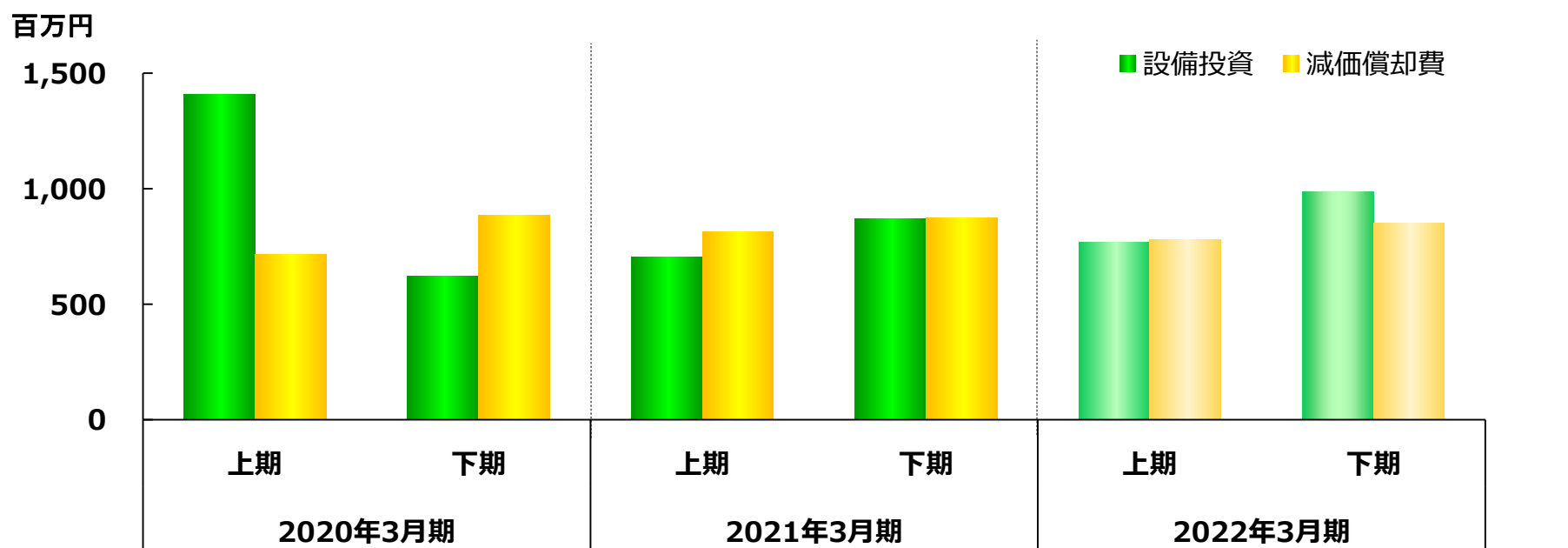
単位：百万円	20年3月期	21年3月期			22年3月期		
	通期実績	通期計画	通期実績	前年比	計画比	通期計画	前年比
設備投資	2,030	2,100	1,574	△22.5%	△25.0%	1,800	+14.4%
減価償却費	1,598	1,700	1,687	+5.6%	△0.7%	1,650	△2.2%



*'22/3は計画

設備投資・減価償却費（半期実績・半期計画）

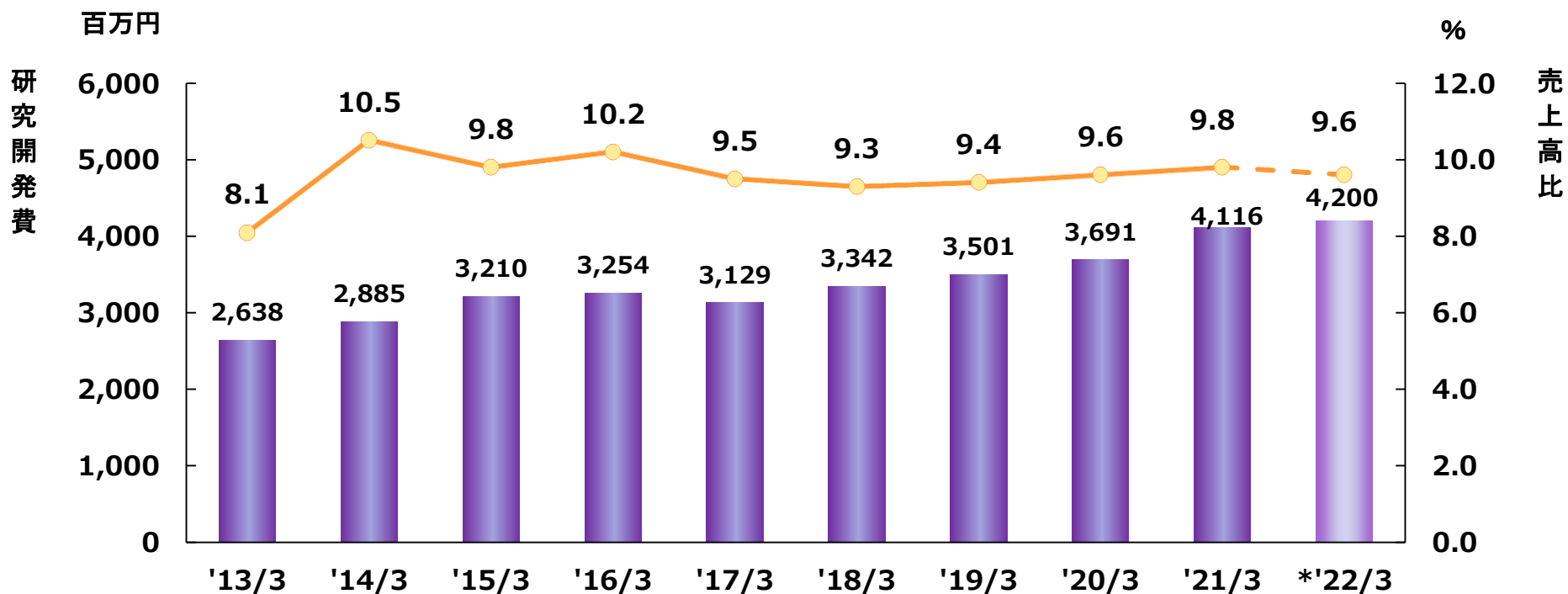
単位：百万円	20年3月期		21年3月期				22年3月期					
	上期 実績	下期 実績	上期 実績	下期 実績	前年 同期比	上期比	上期 計画	前年 同期比	前年 下期比	下期 計画	前年 同期比	上期比
設備投資	1,409	621	704	870	+40.1%	+23.6%	800	+13.6%	△8.0%	1,000	+14.9%	+25.0%
減価償却費	715	883	815	872	△1.2%	+7.1%	800	△1.8%	△8.4%	850	△2.6%	+6.3%



* '22/3 (上) (下) は計画

研究開発費／売上高比（通期実績・通期計画）

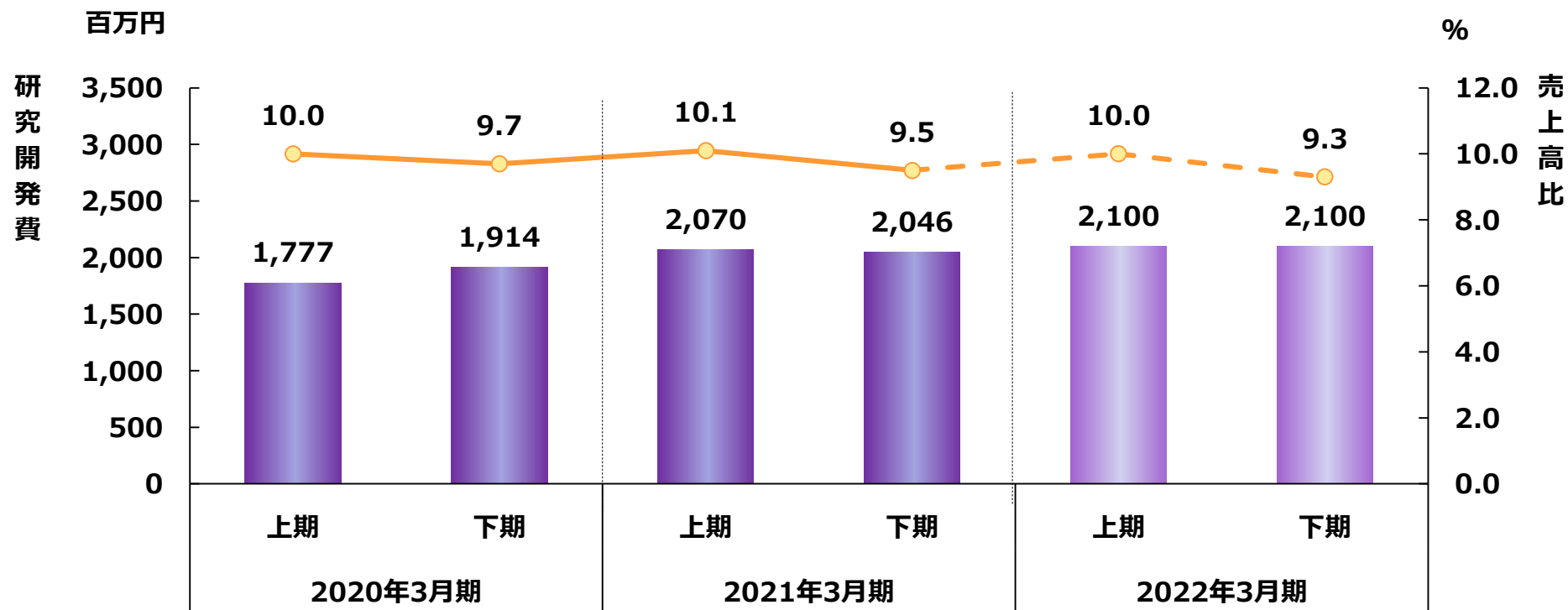
単位：百万円	20年3月期	21年3月期			22年3月期		
	通期実績	通期計画	通期実績	前年比	計画比	通期計画	前年比
研究開発費	3,691	4,000	4,116	+11.5%	+2.9%	4,200	+2.0%



*'22/3は計画

研究開発費／売上高比（半期実績・半期計画）

単位：百万円	20年3月期		21年3月期				22年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	前年同期比	上期比	上期計画	前年同期比	前年下期比	下期計画	前年同期比	上期比
研究開発費	1,777	1,914	2,070	2,046	+6.9%	△1.1%	2,100	+1.4%	+2.6%	2,100	+2.6%	0.0%



*'22/3 (上) (下) は計画

損益分析

営業利益増減分析 20/3期実績→21/3期実績

売上高 384億円

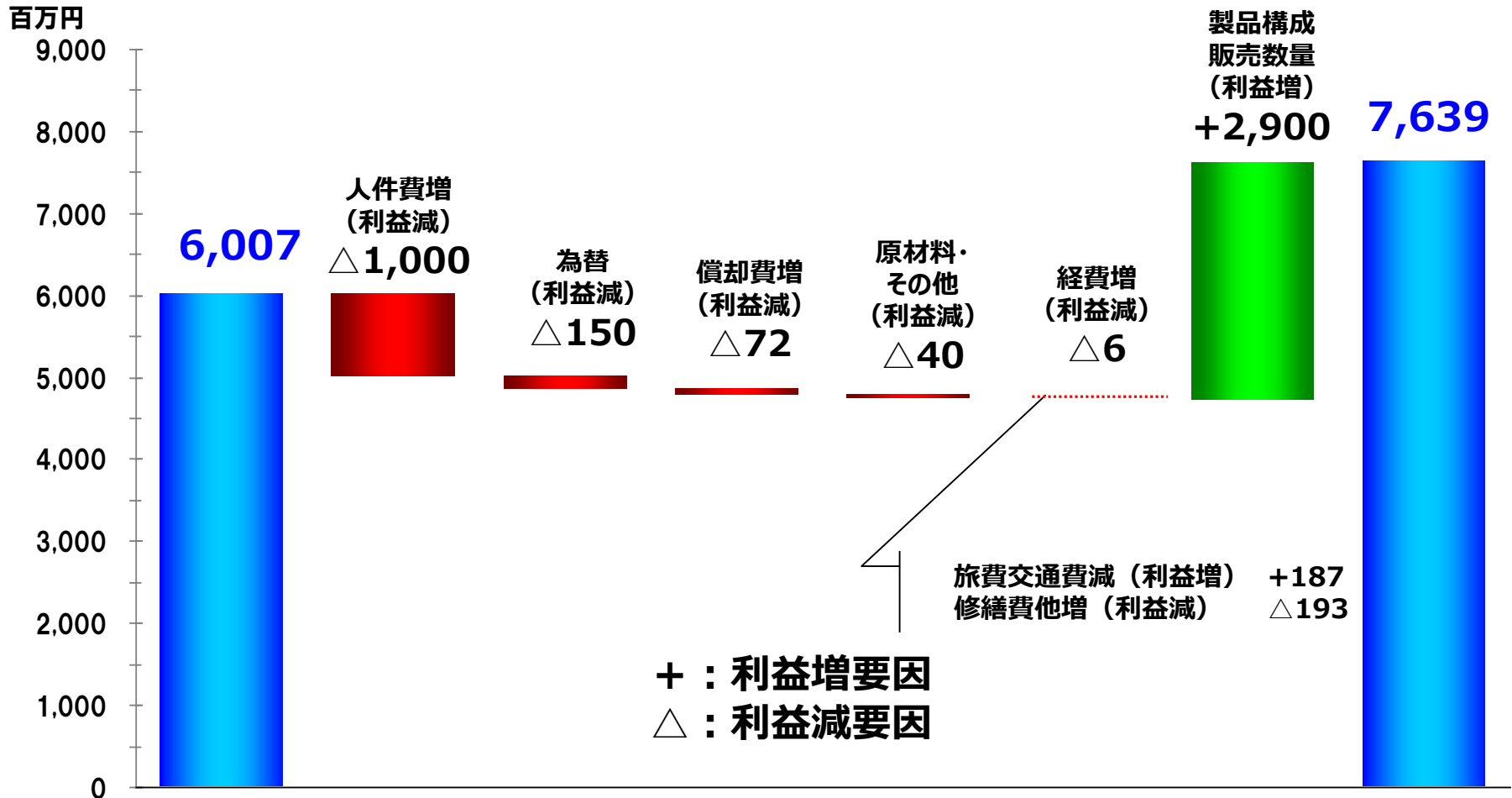
419億円

20/3期
実績

(売上増)+3,548百万円

21/3期
実績

(利益増)+1,631



営業利益増減分析 21/3期実績→22/3期予想

売上高 419億円

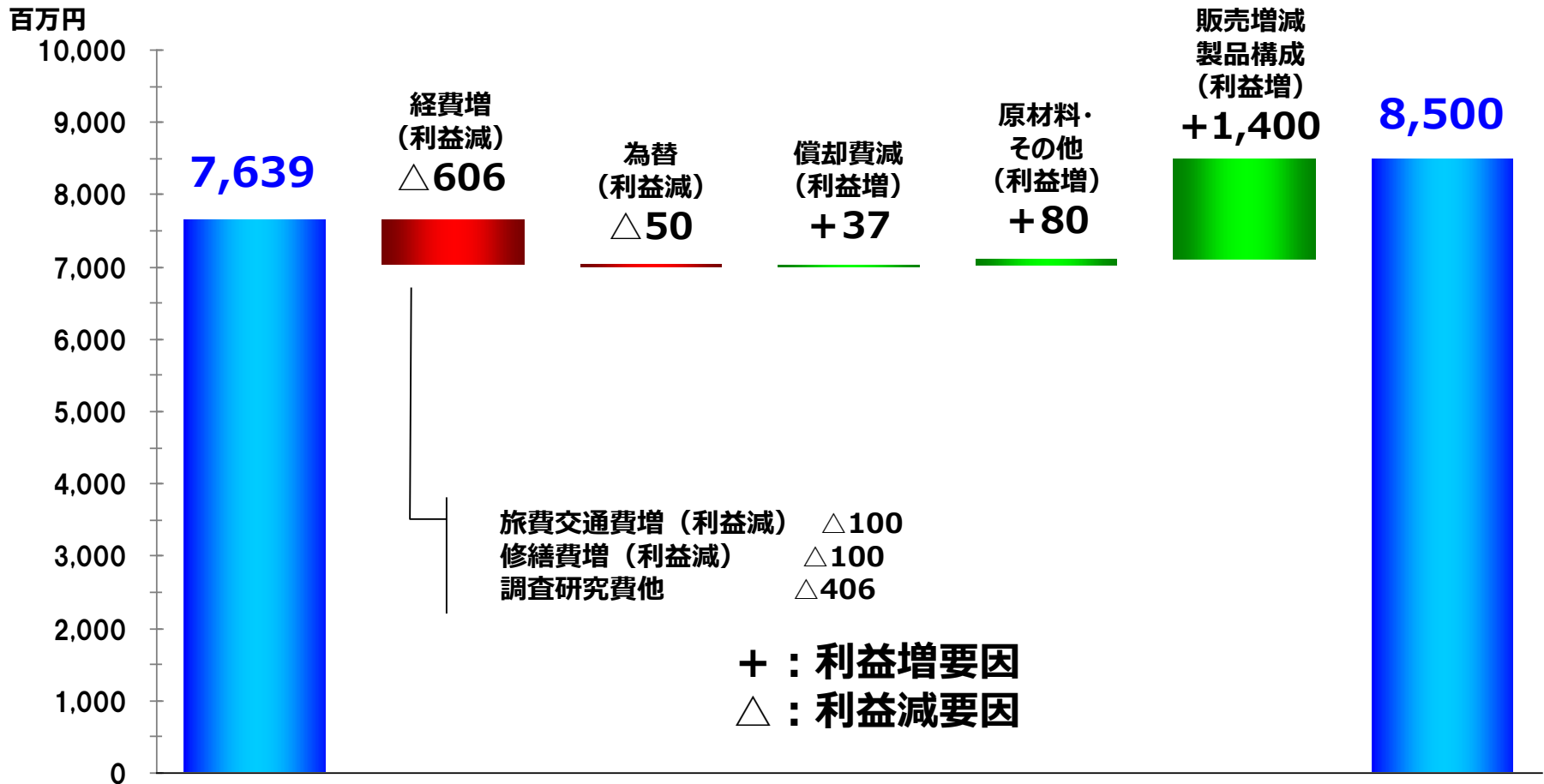
435億円

21/3期
実績

(売上増) + 1,544百万円

22/3期
予想

(利益増) + 861



株主還元

積極的な株主還元と安定配当の継続

■ 利益配分に関する基本方針

1. 連結配当性向 50%以上
2. 安定配当の継続

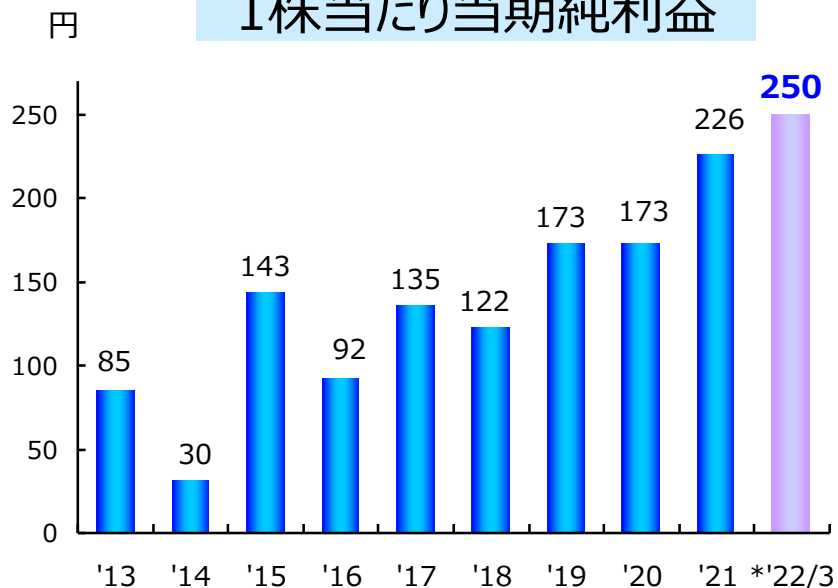
■ 1株当たり配当金 **3期連続で連結配当性向50%超**

	2019/3月期		2020/3月期		2021/3月期	
	期初予想 2018/5/11	実績 2019/5/10	期初予想 2019/5/10	実績 2020/5/13	予想* 2020/11/4	実績 2021/5/12
中間配当金	40円	40円	40円	40円	50円	50円
期末配当金	40円	47円	40円	47円	50円	65円
年間配当金	80円	87円	80円	87円	100円	115円
配当性向	50.6%	50.3%	54.9%	50.3%	47.5%	50.7%

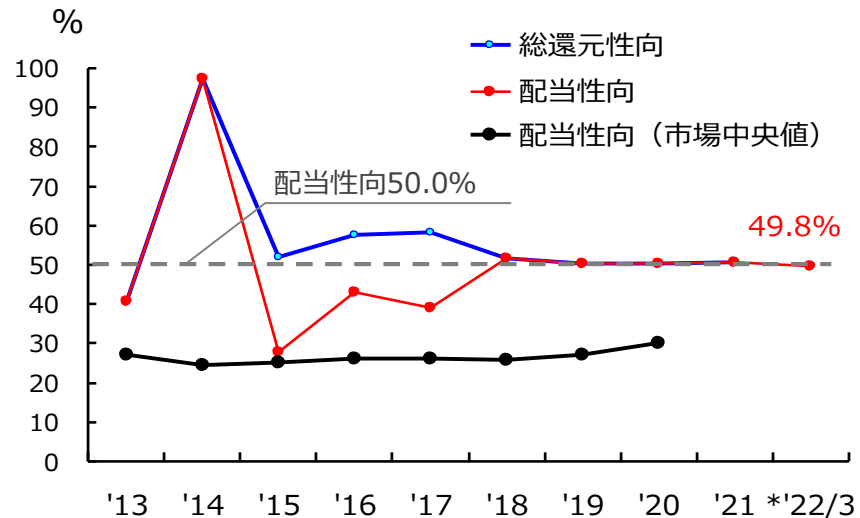
*2021/3月期の期初予想はコロナ影響により未定とした。

積極的な株主還元と安定配当の継続

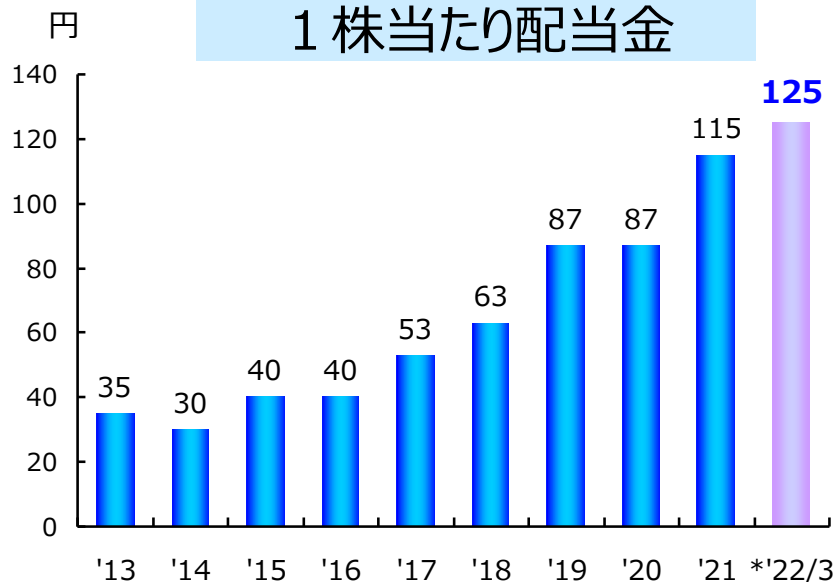
1株当たり当期純利益



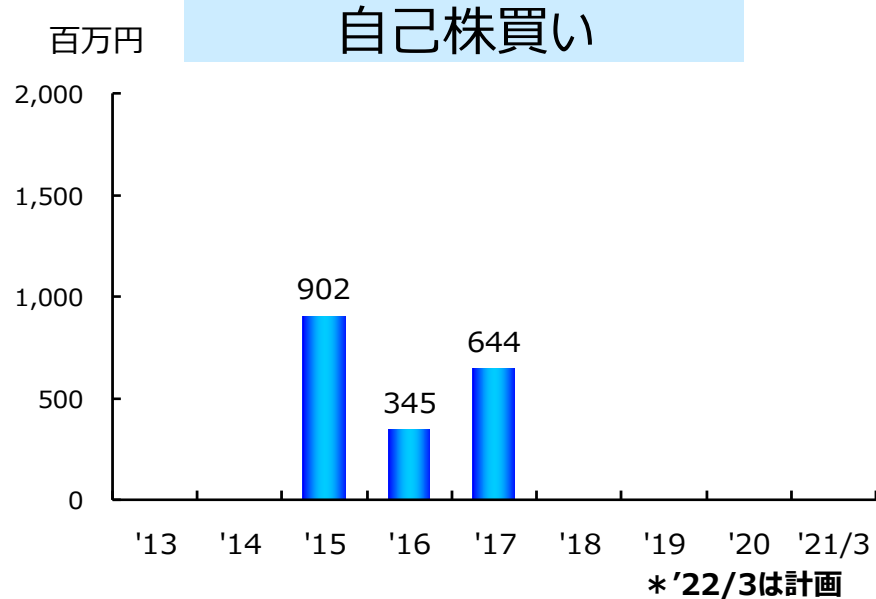
総還元性向・配当性向



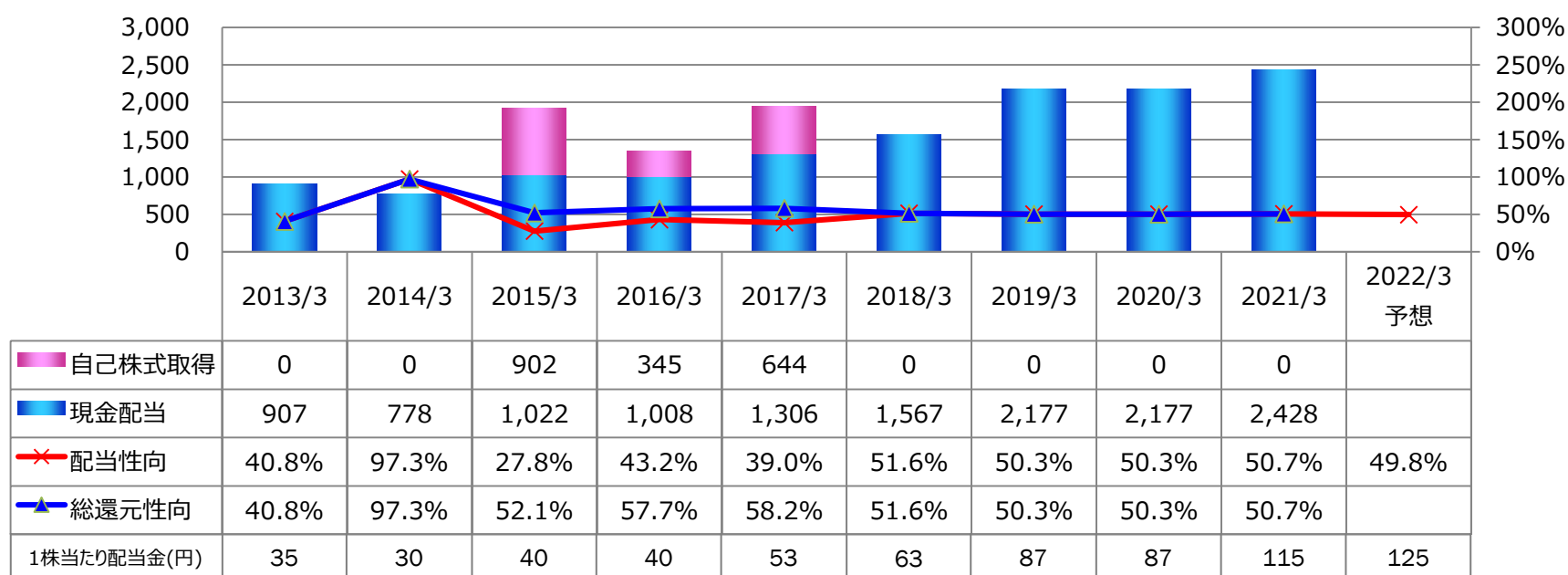
1株当たり配当金



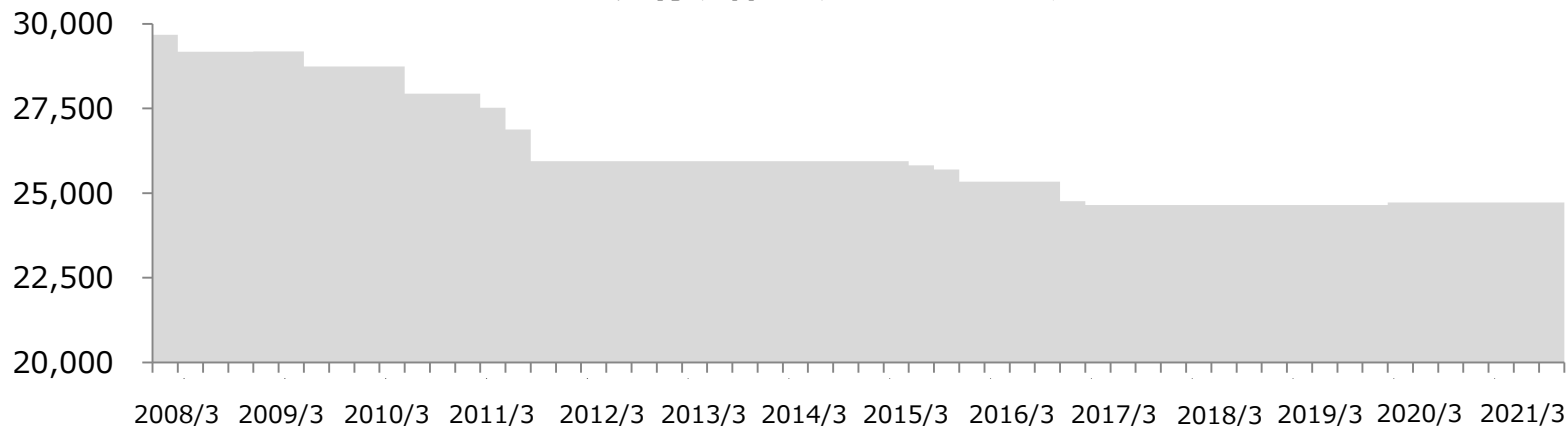
自己株買い



配当総額と配当性向



発行済株式数 (自己株式は除く)



2021年3月期 業績サマリー／2022年3月期 業績予想

【2021年3月期 業績】

✓ 売上高	+9.2%*	: 最先端半導体デバイス向けCMP製品・シリコンウェハー向け製品の販売が好調
✓ 営業利益	+27.2%	: 最先端半導体関連製品の売上増加に加え、製品ミックスの良化
✓ 経常利益	+24.8%	:
✓ 当期純利益	+31.3%	: 営業利益・経常利益は2期、当期純利益は3期連続で過去最高を更新
✓ CMP向け	+15.4%	: 最先端半導体デバイス向け製品の販売増加により 6期連続で過去最高売上高を更新
✓ シリコンウェハー向け	+10.3%	: 半導体業界の高い稼働に支えられ、ラッピング・ポリシングともに増収
✓ ハードディスク向け	△21.2%	: 顧客のプロセス変更に伴う使用量減等により減収
✓ 一般工業用向け	+3.7%	:
✓ 株主還元		: 3期連続で連結配当性向 50%以上

【2022年3月期 業績予想】

✓ 売上高	+3.7%	: 最先端半導体関連製品の販売増加で 過去最高を見込む
✓ 営業利益	+11.3%	: 最先端半導体向け売上増加に加え、製品ミックスの良化
✓ 経常利益	+11.5%	:
✓ 当期純利益	+10.6%	: 営業利益・経常利益・当期純利益ともに過去最高を見込む

*前期比

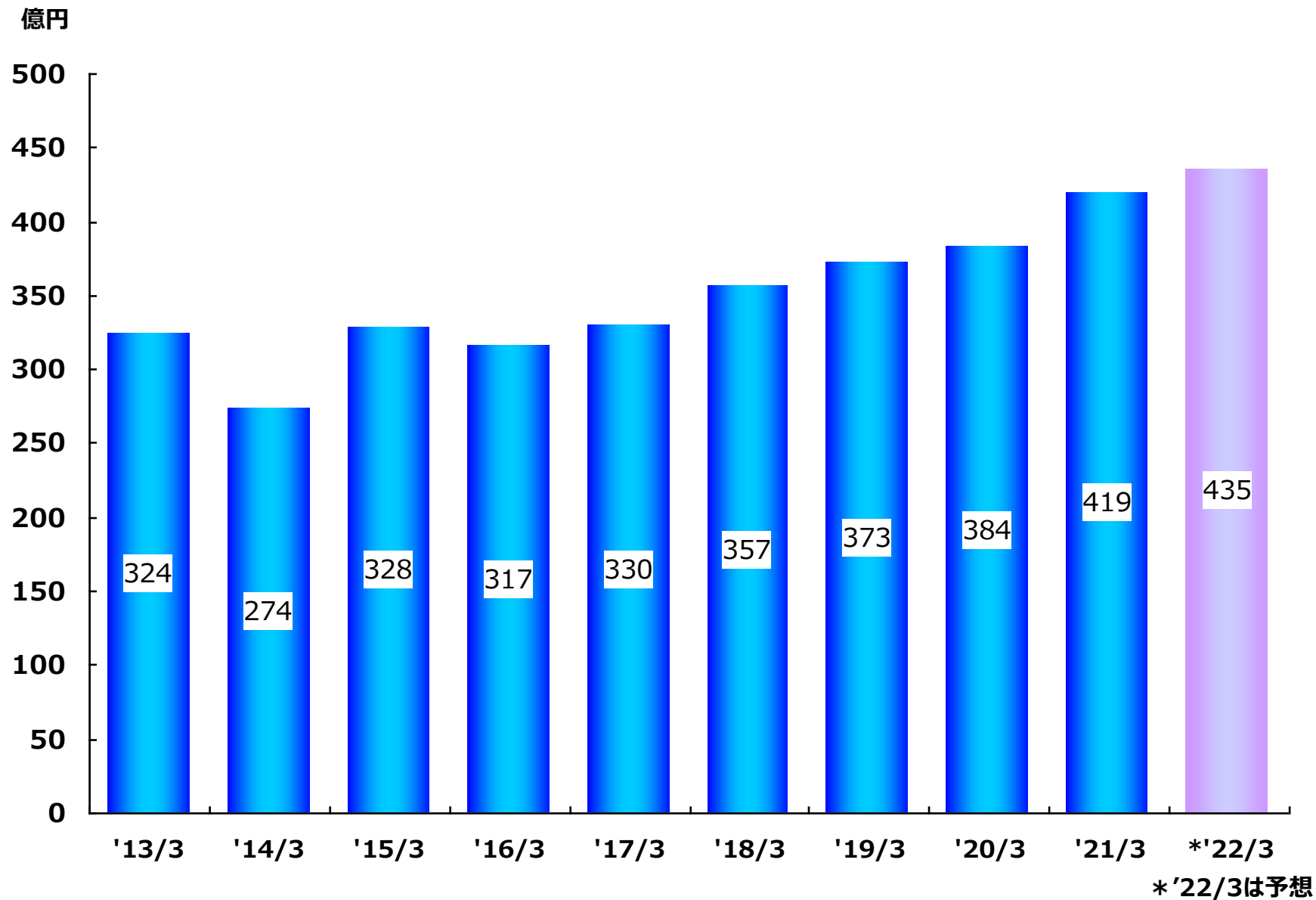
補足資料

グループ人員 内訳

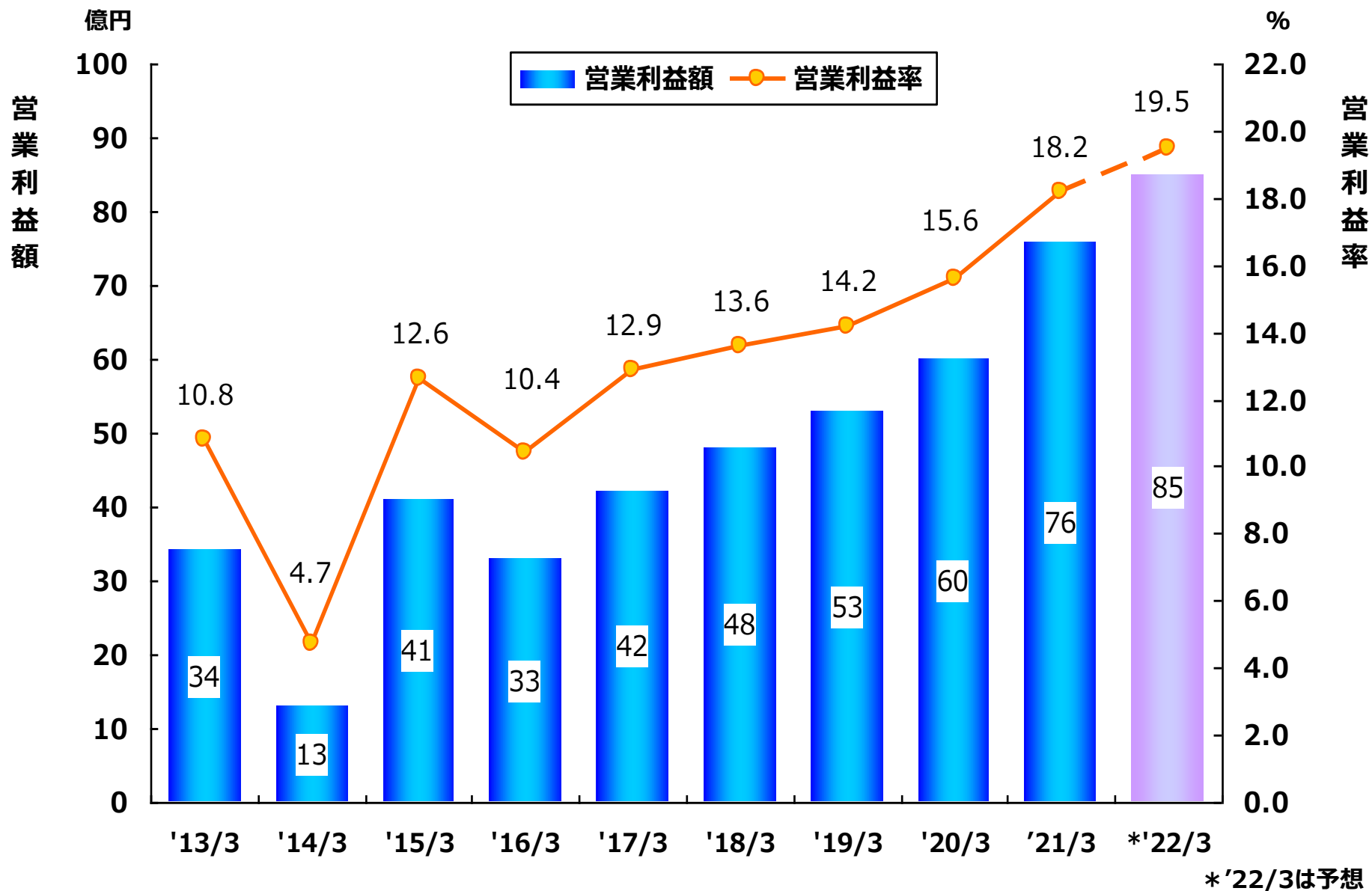
(人数)	20年3月期 (3月31日現在)		21年3月期 (3月31日現在)			
	正社員	臨時 雇用者 *	正社員	臨時 雇用者 *	前期末増減	
					正社員	臨時 雇用者
フジミインコーポレーテッド	636	192	670	187	+34	△5
フジミコーポレーション	108	1	117	2	+9	+1
フジミ台湾	86	2	91	2	+5	—
フジミマイクロテクノロジー	66	5	69	4	+3	△1
フジミヨーロッパ	5	2	5	2	—	—
フジミ韓国	4	1	4	1	—	—
フジミ深圳	3	1	2	1	△1	—
合 計	908	204	958	199	+50	△5

* 臨時雇用者（嘱託、パートタイマー、人材会社からの派遣社員）は年間の平均人員

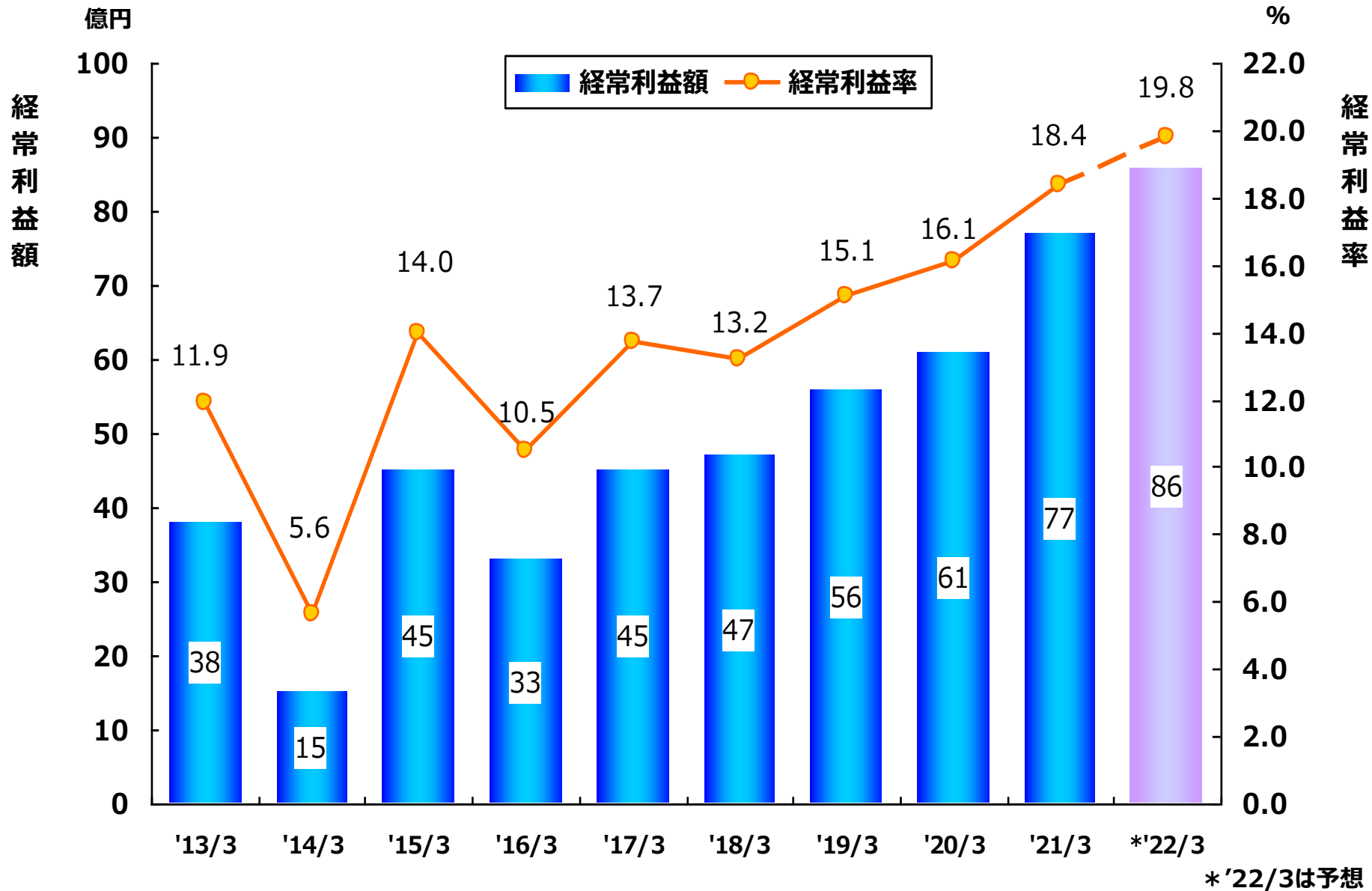
売上高 (通期)



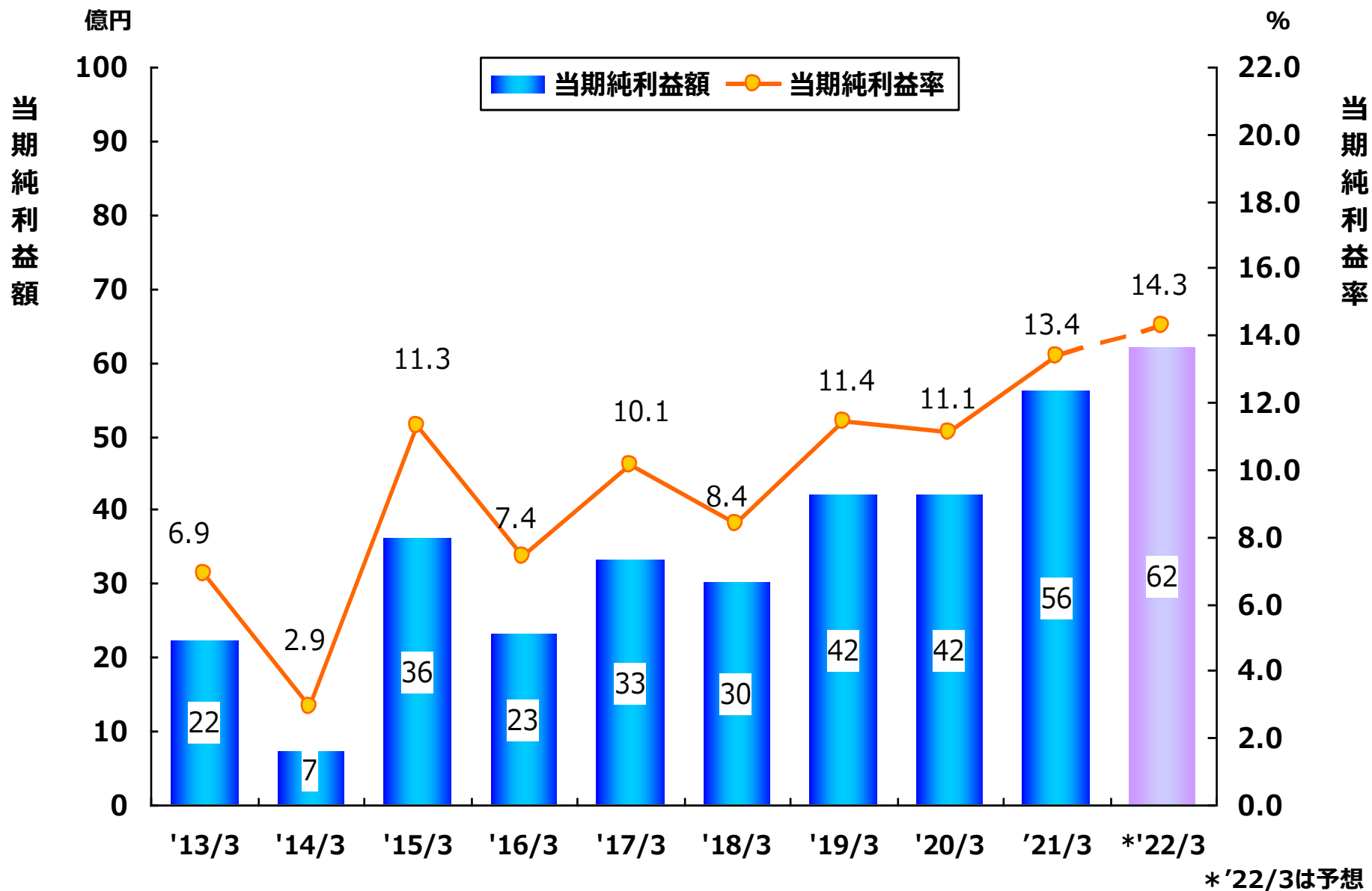
営業利益 (通期)



経常利益 (通期)

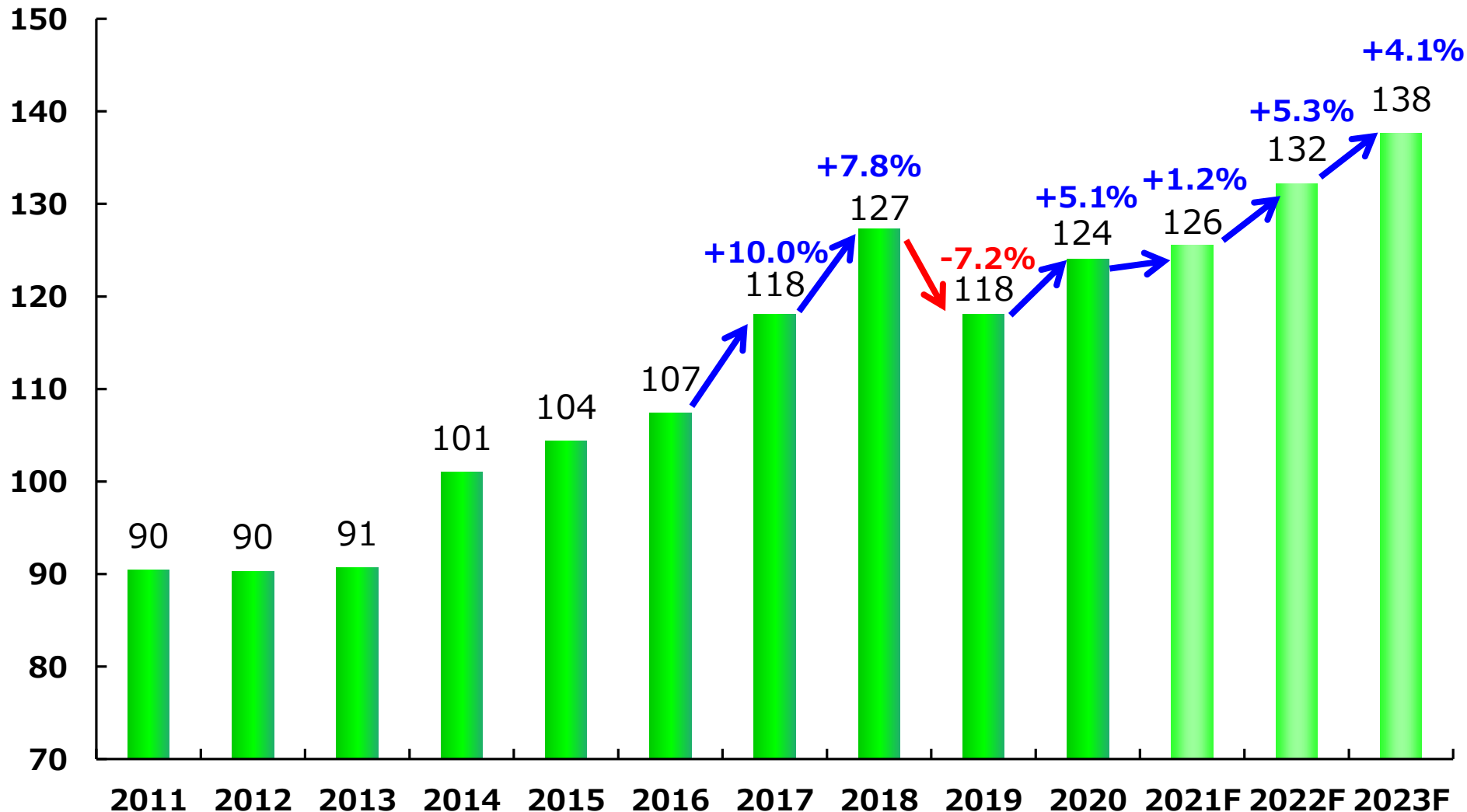


当期純利益 (通期)



シリコンウェハー需要予測 (出荷面積換算 全口径)

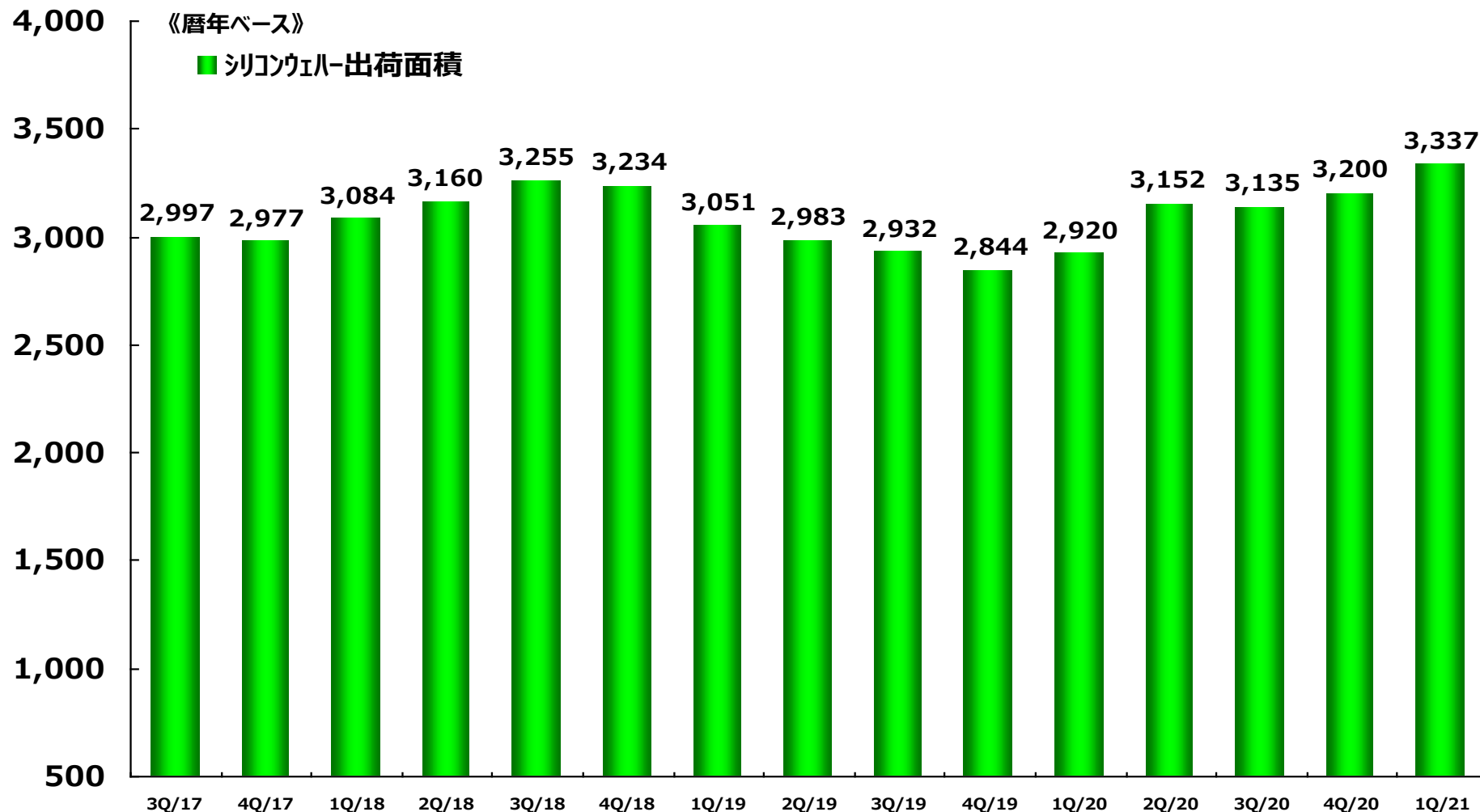
億平方インチ



出所：SEMI (実績 2021/2/2 予想 2020/10/13)

シリコンウェハー出荷面積 (四半期)

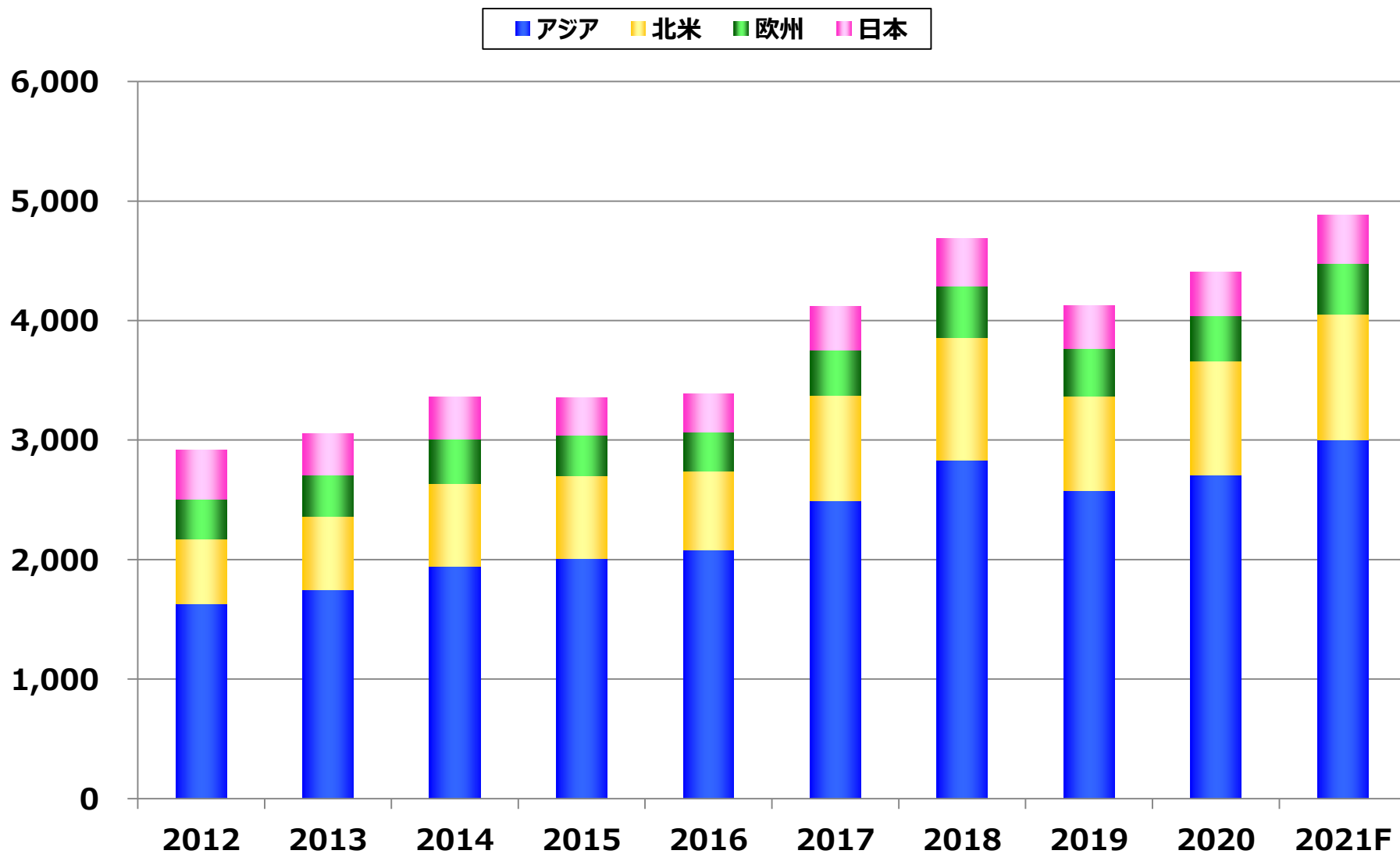
百万平方インチ



出所：SEMI (2021/5/3)

半導体市場規模 (地域別)

(単位：10億ドル)



出所：WSTS (2021/3/17)